

國立成功大學
工學院工程管理碩士在職專班
碩士論文

專利申請之專利說明書撰寫模式研究
以新型說明書為例

Patent Description Writing Mode Research of Patent
Application - A Case Study of Utility Patent Description

研究生：黃國賢

指導教授：陳志方

中華民國九十二年六月十日

國立成功大學
工學院工程管理碩士在職專班
碩士論文

研究生：黃國賢

本論文業經審查及口試合格特此證明
論文考試委員

指導教授：陳志方

系(所)主管：王政宏

張宗進

王明陞

中華民國九十二年六月十日

摘要

近年來專利對於企業的重要度與日俱增，無論是用專利作為商業攻擊的武器亦或是作為防禦侵權的利器，其基本功夫就是申請專利範圍。而「申請專利範圍」是專利實務上的一個很特別產物，因為它的存在而使專利說明書不僅是技術文獻，同時也是權利文獻，所以專利說明書是一包含了專利之技術面分析及相關權利。

本研究試圖以一新型專利說明書來進行專利說明書模式分析，藉由者觀察分析後所產生的資訊，探討這些資訊對於企業在申請專利時會有何種影響。

在專利說明書模式分析方面，根據目前學界所規範的模式加以定義及分析，以便能更進一步瞭解其所規範背後所要表達的意義及所適用的範圍。

運用專利資料庫搜尋數篇新型專利說明書，依據目前學界所規範的模式來加以檢定及分析所搜尋新型專利說明書屬於何種模式或已經使用非學界所規範模式來做為專利說明書之撰寫模式。

最後，對於專利說明書撰寫模式進行分析比較，從撰寫模式、專利事務所及年代不同構面切入，找尋出其相關連性或差異性，以提供企業在專利申請時能正確且適當的選擇專利說明書撰寫模式，來確保自身的權益

關鍵字: 專利、申請專利範圍、專利說明書、新型專利說明書

Abstract

Patent is of great importance to enterprises growing with each passing day. It is base either utilized for offensive weapons of business or means of defense and tort for applying the scope of Patent. "Claims" is a special product in execution of Patent, it make Patent Description not only become technical literature but also right literature, so Patent Description involved technical analyses and related rights.

Patent Description mode analysis processing attempted based on Utility Patent Description for the research, and investigated effect of information while enterprises apply Patent instruction through observation and analysis results.

Patent Description mode analysis defined and analyzed based on the standard of academic circle, so that further understand the meaning and fit in with scope of the standard.

Used Patent's database for several new modes search of Patent instruction and depends on the mode of academic circle established to check and analyze the modes which searched Patent instructions belong or it had depended on non-academic circle's mode for writing mode of it.

Finally, Patent Description writing mode will be analyzed and compared through different views, including writing mode, Patent office and years to look for related or difference, and then the enterprises will be able to choose correct and suitable Patent instruction writing mode to assure themselves rights and interests when they apply Patent.

Key word: Patent、Claim、 Patent Description and Utility Patent Description

誌謝

回首三年，光陰似箭，昨日踏入成大校園的情景，歷歷在目。同學間相互的鼓勵與期勉，猶言在耳，離開總有不捨但也有期待，人生在不斷的抉擇中顯得更加精采燦爛。感謝父母親的鼎力支持，讓我一路走來，順心如意。

三年的校園生涯，除了要兼顧工作上的瑣碎事項，在課堂上更要拋去工作上煩憂，沉澱思慮，吸取新知。感謝恩師陳志方博士諄諄教誨，使我受益良多。其亦師亦友的相處態度，更令人激賞。

三年間結交不少好友，感謝勇龍、俊吉、良哲這三位同學，相互扶持；才使得在課業上得以順利完成。論文即將付梓，回顧寫作歷程，要感謝陳志方博士在論文主體上的指導、專利事務所的文中兄、明輝兄及佶龍兄在key word 及實務面上的協助，才能讓本文順利完成。

一路上默默陪在我身邊的老婆靜方，承擔了不少的壓力與責任，有妳的支持我分感謝，這份喜悅願與妳分享。

『學習是一條漫長的路，畢業不是終點，而是重新出發』

黃國賢 謹識于
國立成功大學工學院工程管理專班
2003.6.10

目錄

第一章 緒論	01
第一節 研究背景與動機.....	01
第二節 研究目的.....	02
第三節 研究範圍.....	02
第四節 研究架構.....	02
第五節 研究方法與步驟.....	04
第二章 文獻探討	07
第一節 智慧財產權.....	07
一、智慧財產權的概念.....	07
二、智慧財產權之特性.....	11
第二節 專利之基本概念.....	13
一、專利（Patent）的定義.....	13
二、專利種類.....	14
三、專利獲得之優點.....	16
四、專利管理.....	18
五、專利分析.....	21
第三節 積體電路布局保護之基本概念.....	23
第四節 高科技產業.....	24
一、高科技產業之定義.....	24
二、高科技產業之特性.....	25
第五節 專利權的權力與保護範圍.....	27
一、何謂專利權.....	27
二、專利權範圍解釋.....	30
三、專利權範圍及專利權保護範圍之區別.....	31

第三章 研究方法及流程	36
第一節 研究限制.....	36
一、專利的限制.....	36
二、以國內專利事務所為對象的限制.....	36
三、說明書研究觀察數較少.....	36
第二節 研究方法.....	36
第四章 專利申請模式分析	39
第一節 專利檢索方法.....	39
一、專利分類檢索.....	39
二、按專利權人檢索.....	40
三、電腦檢索.....	41
第二節 專利說明書撰寫模式分析.....	43
一、通則.....	43
二、請求專利記載模式.....	44
第五章 研究結果	55
第一節 請求專利部份模式分析.....	55
一、電子構件送料軌道結構改良.....	55
二、具有一吸管之液體容器.....	56
三、迷你光碟片包裝盒.....	59
四、蒸餾水之握把.....	60
五、緊急按鈕保護蓋.....	61
六、光感測半導體元件之構裝結構改良.....	62
七、分歧器之結構改良.....	63
八、可快速組裝之插座.....	64
九、通訊接頭之防潮裝置.....	66

第二節 分析結果.....	67
一、請求專利部份模式驗證結果.....	67
二、撰寫模式潮流.....	68
三、申請專利範圍限制.....	68
第六章 結論與建議.....	72
第一節 專利範圍侵權案例分析.....	72
第二節 專利與申請的關係.....	75
第三節 結論.....	76
第四節 建議.....	76
參考文獻.....	77
自述.....	89

圖目錄

圖 1-1	本文架構.....	04
圖 1-2	研究步驟.....	06
圖 2-1	智慧財產權用語.....	09
圖 2-2	專利管理制度.....	20
圖 3-1	研究流程.....	38
圖 4-1	專利分析流程.....	42
圖 4-2	A、B、C 之技術關係.....	45
圖 4-3	A、B、C 之技術關係.....	47
圖 4-4	A(a ₁ ※a ₂)、B、C 之技術關係.....	47
圖 4-5	A、B、C 之技術關係.....	48
圖 4-6	A(a ₁ ※a ₂)、B、C 之技術關係.....	49
圖 4-7	A、B、C、D 之技術關係.....	49
圖 4-8	A、B、C、C1、C2 之技術關係.....	50
圖 4-9	AB、BC 之技術關係.....	51
圖 4-10	A、B、C 之技術關係.....	52
圖 4-11	A、B、C 之技術關係.....	52
圖 4-12	A、B、C、D 之技術關係.....	53
圖 4-13	A、B、C、D 之技術關係.....	53
圖 5-1	撰寫模式所佔比例.....	71

表目錄

表 2-1	專利分類表.....	15
表2-2	專利管理四個階段.....	19
表 4-1	國際專利分類號.....	40
表 4-2	專利資料庫網址.....	41
表 5-1	專利分析結果總表.....	69
表 5-2	專利事務所申請模式統計表.....	71
表 6-1	撰寫模式特性.....	75

中英文縮寫全名對照

-A-	Agreement on TRIPS	與貿易有關之智慧財產權協議	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods
-B-	BLS	美國勞工統計局	Bureau of Labor Statistics
-G-	GATT	關稅暨貿易總協定	General Agreement on Tariffs and Trade, GATT
-I-	IPR	智慧財產權	Intellectual Property Right
	IPC	國際專利分類號	International Patent Classification
-T-	TRIPS	與貿易有關之智慧財產權協定	Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods
-U-	UPC	美國專利分類號	United States Patent Classification
	URAA	烏拉圭回合	Uruguay Round Agreements Act
-W-	WIPO	世界智慧財產權組織	World Intellectual Property Organization
	WTO	世界貿易組織	WORLD TRADE ORGANIZATION

第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

在這個今日企業充滿競爭的戰場上，各家廠商無不斷的在自家的產品上不斷推陳出新，以期望能滿足社會上大眾的需求，進而使公司能獲得利益來使企業長期發展。而智慧財產權（Intellectual Property Right；IPR）係在廠商因不斷競爭科技研發所衍生出的一種權利。長期以來，科技與法律一直無法同步之主要原因在於法律規範一直無法追及科技發展之速度，均是等到事態嚴重時才會開始製訂相關法律條文來加以規範，因此導致有關智慧財產權的相關觀念長期短缺，造成業者的損失更難以估計。

近幾年來世界大廠紛紛運用智慧財產來作為牽制競爭對手的一項利器，其中最常見的便是專利侵害之訴訟。廠商在研發與生產製造之初，如未能對相關技術進行詳細之專利分析，如發生專利侵權行為時在面對外國廠商追索權利金，將會付出慘痛的代價，小則賠錢了事，大則喪失市場版圖，更嚴重的公司可能因此倒閉。探究專利設置的目的，就是為允許發明人於特定時間內禁止他人製造、使用或販賣其發明，以保護發明人創作的權益。對於產業界而言，愈詳細的專利資料，將使得廠商愈容易也愈正確擬定公司的經營策略、研發策略及專利策略。因此如何在研發之初就做好全盤的分析與規劃，乃至擬定整套的研發策略規劃及部署，是企業領導人必須加以正視的課題。

國內產業正處於蛻變的階段，而智慧財產權的保護對於公平競爭、研發及創新更是不可或缺，倘若未能完善規劃公司本身的智慧財產權管理，不僅無法保障本身之智慧心血，恐亦有侵犯他人而導致嚴重損失之虞。有鑑於此，企業唯仰賴創作研發並提升產品品質，輔以完善的智慧財產權管理制度，始克提升公司之競爭優勢，以臻永續經營之境。

第二節 研究目的

現行的專利制度，是藉由著法律來賦予法定排他性之獨占權，用以來鼓勵創新、提高生活水準，而藉由透過早期公開方式以達到節約社會成本之制度。依照專利法第一條「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法」即可明瞭專利法之立法目的，除在保障專利權人利益外，亦在透過專利制度，使技術公開，使社會分享該進步之便，以促進社會整體技術進步。而在申請專利的過程中全依賴專利說明書來加以表示所欲申請專利內容，所以如何有效的將欲申請專利的內容表現在專利說明書上，對於申請專利而言是一項很重要的事項。本研究主要目的計有：

1. 專利申請管理流程的認知。
2. 標準專利說明書模式的認知
3. 透過與專利工程師訪談及現有資料搜尋確定專利說明書撰寫模式。
4. 探討現行實際專利說明書與標準專利說明書模式差異

第三節 研究範圍

在對專利說明書的分析中，本研究是以採用中華民國專利公報資料庫的資料為主體研究對象。而中華民國專利公報資料庫則是含括我國歷年專利申請的核准資料，而採用專利資料來做的各項討論，主要是由於專利體系發展已愈趨完整，而專利之認證又具有一定的法律效力及特定的認證程序，使得專利說明書有相當的可信及可靠度，應用的範圍也愈來愈為廣泛，因此本研究以專利說明書資料來探討之。

第四節 研究架構

本研究架構如圖1-1所示。首先乃針對智慧財產權進行全盤性的了解與分析。專利工程師意見有助於更加認識專利申請關鍵技術，掌握正確的關鍵技術將會決定專利分析的正確性。透過專利資料庫檢索（應用檢索軟體工具），可以獲得有效的專利資訊，進而進

行專利說明書撰寫模式探討。再者，輔以國內業者、專利工程師的訪談，以解讀專利說明書分析後結果，從而探討專利說明書撰寫模式的關係及影響。

本研究之論文架構：

第一章 緒論

說明本研究的背景、動機和研究目標及問題，以釐清研究認知。

第二章 文獻探討

- 1.整理各文獻的理論，來說明智慧財產權、專利所代表的意義與法律上的位階。
2. 提出學者在各主題上對專利的各項不同領域的解釋。

第三章 研究方法及流程

針對研究對象及範疇做出定義並討論其限制後，再對研究目的實踐之方法及流程作進一步探討。

第四章 專利申請模式分析

針對目前學術界所規定的各種專利說明書模式加以說明

第五章 研究結果

選定國內前三大專利事務所，並以智慧財產局專利資料庫來作搜尋的資料庫。將所搜尋出的九篇專利說明書加以分析討論。

第六章 結論及建議

針對各項研究提出結論與建議事項

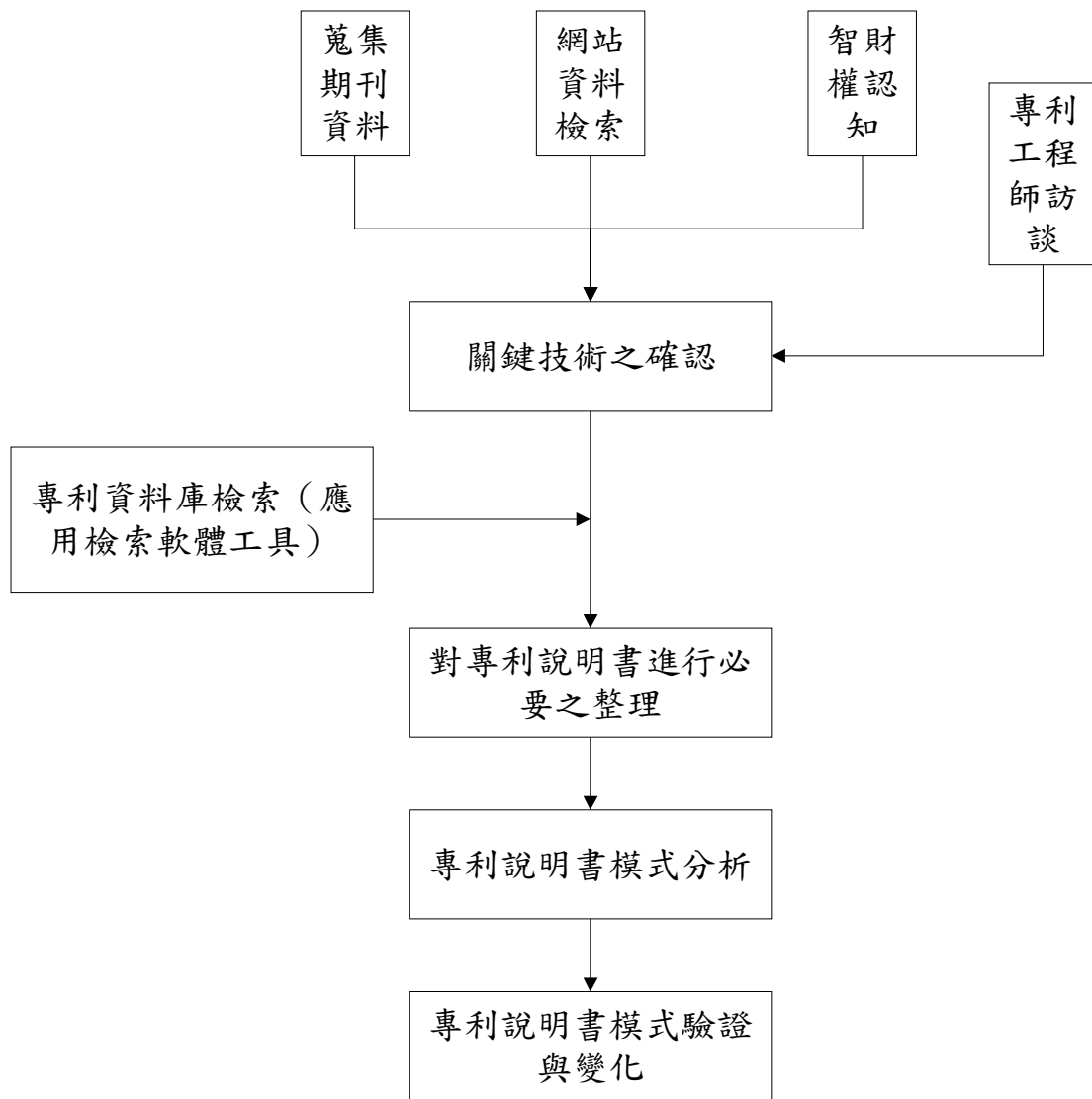


圖 1-1 本文架構(資料來源:本研究整理)

第五節 研究方法與步驟

本研究所採用之方法為資料蒐集、分析與研判法、專家訪談法及專利分析法。藉由廣泛研究相關學術期刊、技術報告、專業書報雜誌及網際網路上的資料，以了解申請專

利制度發展的現況及專利說明書撰寫模式，同時對專利相關專業知識進行搜索，進而掌握專利分析的要領。除了文獻資料分析之外，更輔以專家訪談，以釐清專利說明書撰寫關鍵技術，作為後續進行專利說明書模式分析的依據。專利分析法則是採用國際專利分類及專利檢索，進行專利搜索。將搜索出的專利說明書套入專利說明書撰寫模式加以分析。

研究步驟如下，如圖1-2：

1. 建立研究主旨
2. 界定研究方向
3. 蒐集相關資料：藉由廣泛研究相關學術期刊、技術報告、專業書報雜誌及國際網路上的資料，以了解覆晶技術發展的現況及整體封裝產業的演進，同時對專利相關專業知識進行搜索，進而掌握專利分析的要領。
4. 專家意見訪談：透過與專家會談，釐清專利說明書撰寫技術，作為後續進行專利分析的依據。
5. 專利檢索及分析：利用專利搜尋軟體，對關鍵詞句進行搜尋，藉此獲得必要之專利資訊。
6. 繪製差異表：根據上個步驟所得到之專利資料加以整理彙總，編製一差異表。
7. 結論及建議：探討專利說明書模式與專利申請之關係及影響。

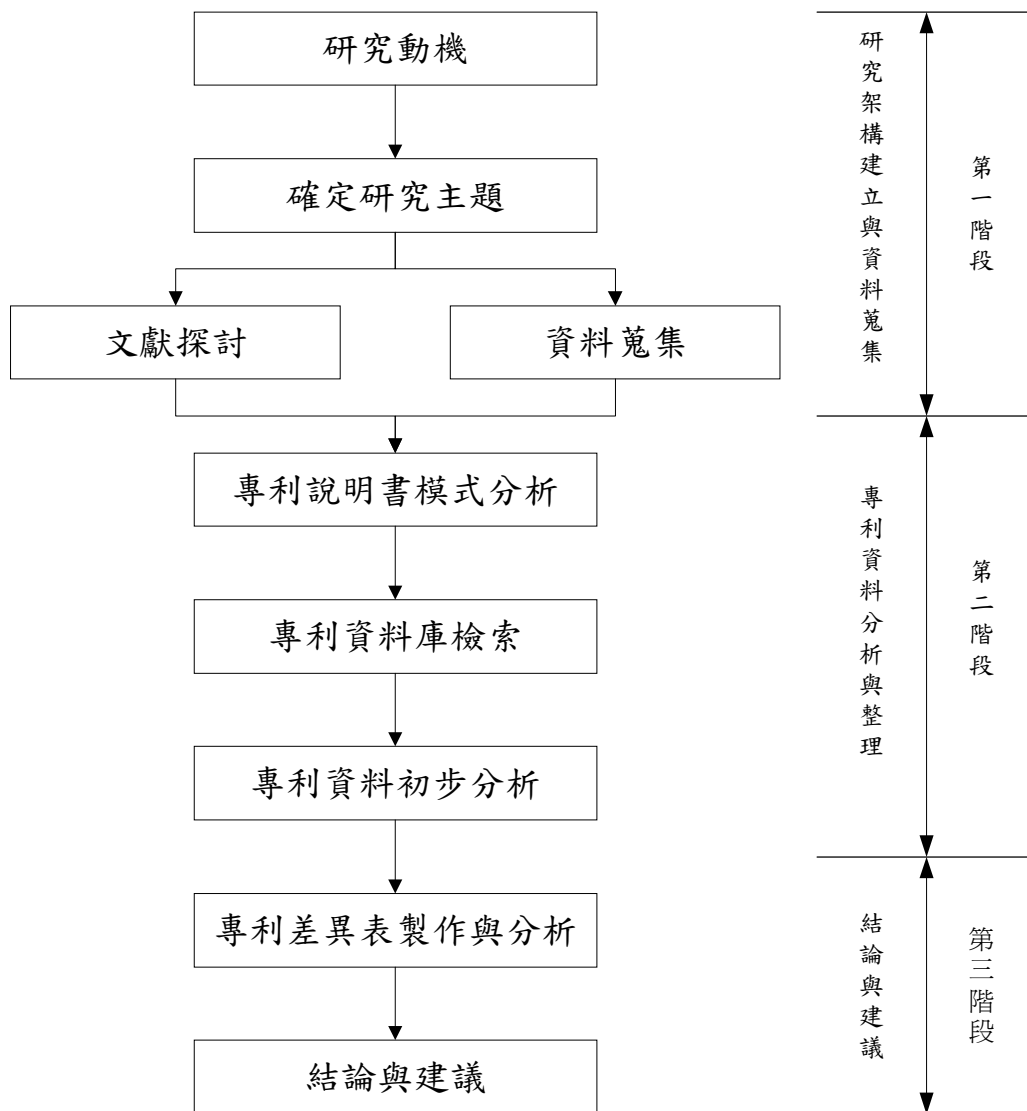


圖 1-2 研究步驟(本研究整理)

第二章 文獻探討

本章文獻探討分成五節，第一節針對智慧財產權的概念及特性介紹；第二節則針對專利內容，包括定義、種類、獲得之優點、管理方式及分析方式來加以解析；第三節則針對積體電路保護法介紹；第四節針對高科技的定義及特性介紹；最後則是針對專利權的權力與保護範圍加以解析。

第一節 智慧財產權

一、智慧財產權的概念

在一般法律所規範及保護出發點是以保護利益為主，但多是以規範及保護有形體的財產法益為主，例如：民法上所規範的動產或不動產等。而近50、60年來，科技、技術日益進步的結果，人們逐漸開始重視無形體的精神創作成果，亦要求能在法律上予以尊重及保護，因此構成除了物權及准物權以外的另一種形式之「無體財產權」。「無體財產權」用語，現在較常用的為「智慧財產權」（或如大陸所稱「知識產權」），該法已為各國及國際組織所重視，並期予各國法律標準化，甚至更期待能達到國際區域的整合（例如歐洲共同體）或世界「統一法」的境界。【1】

「智慧財產權」（Intellectual Property Rights, IPR, 德文Geistiges Eigentum），中國大陸稱「知識產權」，其係指人類精神活動之成果而能產生財產上之價值者。因此，「智慧財產權」必須兼具「人類精神活動之成果」，以及能「產生財產上價值」之特性。就「人類精神活動之成果」之特性而言，如果僅是體力勞累，而無精神智慧之投注，例如僅作資料之辛苦蒐集，而無創意之分類、檢索，並不足以構成「人類精神活動之成果」。又此一「人類精神活動之成果」如不能「產生財產上價值」，亦無以法律保護之必要。必須具有「財產上的價值」，才有如一般財產加以保護之必要。「智慧財產權」同時是一種「無體財產權」，亦即其保護客體並無一定之有形物體，純屬法律上抽象存在之概念，其

與汽車、鋼筆等屬於「有體財產權」之物權並不相同，二者有時或並存，有時也不同時存在。當轉讓一件智慧財產權所附著之物時，如無特別約定，通常僅屬該智慧財產權所附著之物之所有權之轉讓，屬物權之讓與，至於智慧財產權則仍未移轉。而通常於轉讓「智慧財產權」時，並無附隨其所附著之物之所有權。最常見之案例如購得一本書時，僅購得該書之所有權，而不包括書之著作權，因此不得加以重製。而購得該書之著作權時，縱使該原本書已滅失，或歸他人收藏，受讓著作財產權之人仍得重製該書。【2】

近幾年來，美國政府挾著新「工業政策」(Industrial Policy)的氣焰，頻頻以「智慧財產權貿易策略」(如三0 一條款、特別三0 一條款及超級三0 一程序)向我國施壓【3】，因此亦迫使急欲加入世界貿易組織WTO的我國【4】，根據GATT的TRIPS的原則【5】，完成了對商標法、專利法及著作權法的修正，並給予電腦軟體著作權的保護。而在立法方面，則是完成了營業秘密法及積體電路布局保護法。

依照一九六七年「成立世界智慧財產權組織公約」(Convention Establishing the World Intellectual Property Organization)第二條第八款所訂定的內容，所謂的智慧財產權，包括了下列各項權利：

1. 文學、藝術及科學之著作
2. 演藝人員之演出、錄音物以及廣播
3. 人類之任何發明
4. 科學上之發現
5. 產業上之新型及新式樣
6. 製造標章、商業標章及服務標章，以及商業名稱與營業標記
7. 不正競爭之防止
8. 其他由人類在工業、科學、文學或藝術領域內一切智慧創作所生之權利

關於智慧財產權的分類，可分見於1883年保護工業財產權巴黎同盟公約對「工

業財產權」見解、1967 年簽署於Stockholm 的世界智慧財產權組織創設公約對「智慧權」用語的定義、「關稅暨貿易總協定(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)」。

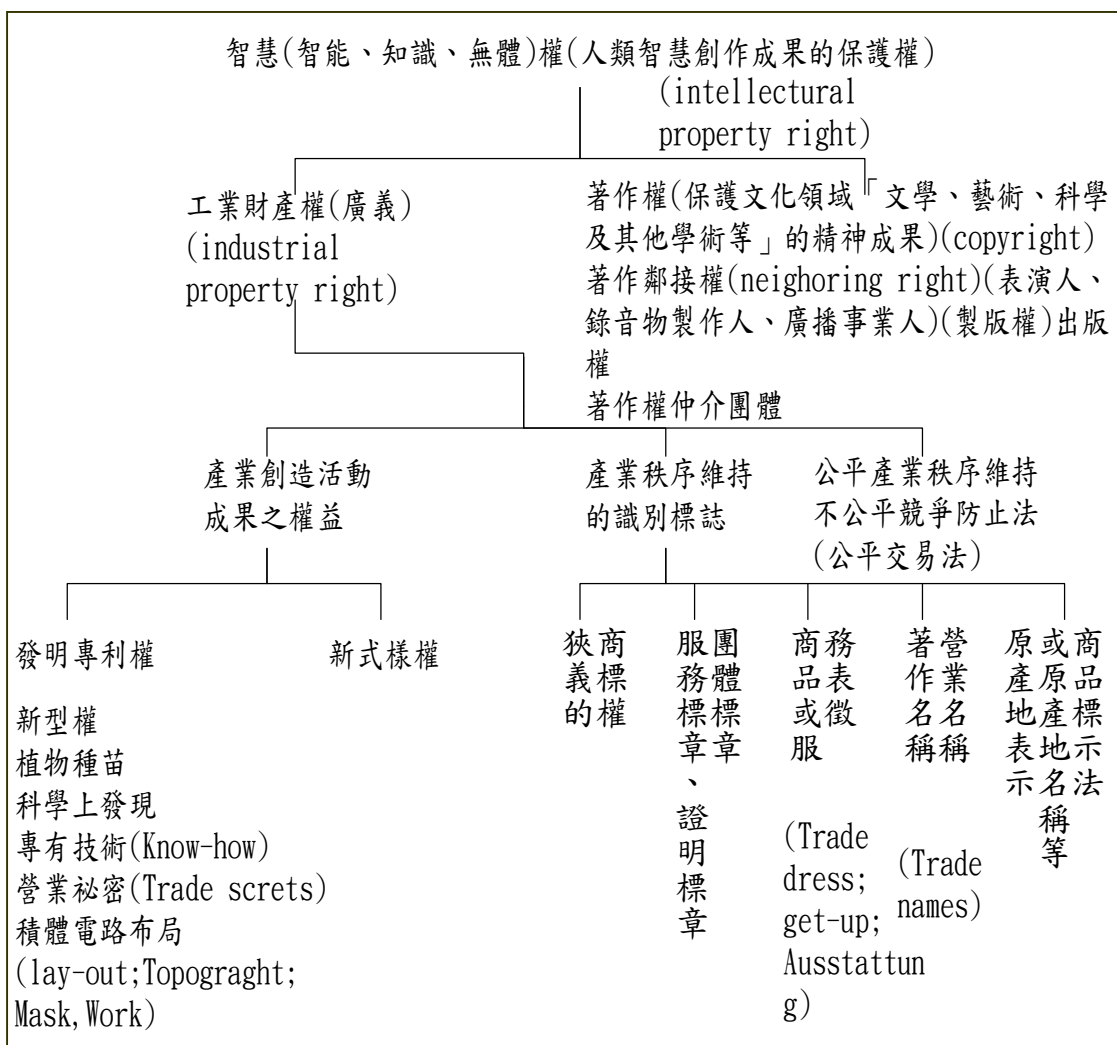


圖2-1 智慧財產權用語

資料來源：智財權教戰手冊，p. 111，2000 年

在一九九三年底，在關稅暨貿易總協定 (GATT) 所召開之「烏拉圭回合」(Uruguay Round Agreements Act, URAA) 談判中【6】，達成最終協議之「與貿易有關之智慧財產權協議」(Agreement onTrade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights, Including Trade in Counterfeit Goods，簡稱Agreement on TRIPS) 中，則將智慧財產權分別歸類如下【7】：

1. 著作權及相關權利
2. 商標
3. 產地標示
4. 工業設計
5. 專利
6. 積體電路之電路布局
7. 未公開資訊之保護【8】
8. 對授權契約中違反競爭行為之管理

在一九九三年十二月十五日達成之最終協議及一九九四年四月於摩洛哥簽署世界貿易組織世界貿易組織(WORLD TRADE ORGANIZATION)協定，其中之「與貿易有關之智慧財產權協定(Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights，including Trade in Counterfeit Goods，簡稱TRIPS)等文件之中。將「智慧財產權」包括以下之範圍：

1. 著作權及相關權利。
2. 商標。
3. 產地標示。
4. 工業設計。
5. 專利。
6. 積體電路之電路布局。
7. 未公開資訊之保護(營業秘密)。
8. 授權契約中違反競爭行為之管理(公平交易)。

綜合上述五項重要的法律協定可以知道，人類已經從過去以體力付出為主的生產型態走向現在以智慧、精神活動為主的創作發明生產型態。更重要的是，將智慧的結晶從物體之中萃取出來，分別以專利權、商標權、著作權、營業秘密及積體電路布局法對工商業加以保護【9】。

所謂智慧財產權的定義究竟是為何？Brooking(1996)認為智慧財產(Intellectual property assets)乃是智慧資產(Intellectual capital)中的一部份【10】。根據徐小波(1990)的定義：智慧財產權的基本概念，是一種人類思維活動的結晶，利用此一結晶，可以生產製造某項產品，或提供特定勞務，在客觀上這種結晶具有金錢價值，得作為交易的標的【11】。

馮震宇(1998)將智慧財產權定義為只要是人類智慧的結晶，例如發明、設計、詩詞散文、戲曲、圖案標記、電腦與電腦軟體、甚至杜撰的人物造型如米老鼠、唐老鴨、東方不敗等，都是智慧財產權【12】。謝銘洋(1997)認為智慧財產權係為鼓勵並保障人類運用其精神力從事創作活動，而對其創造的成果所賦予之權益的總稱【13】。賴源河(1991)稱智慧財產權者，謂以人類之創造活動及營業上標誌為對象之權力或保護利益而言【14】。張忠謀(1995)則認為企業內任何和商業行為、和營運有關的構思(idea)或卓見(insight)，只要是別人所不知，就是智慧財產，就應該全部加以保護【15】。而Timo和Sami(1999)則認為高科技智慧資產(High technology intellectual capital)意指所有能夠提昇高科技水準及生產力的因素【16】。

綜合上述，本研究將智慧財產權定義為：智慧財產權乃是從人類思想、創意到成果一連串的智慧結晶，且具有無形或有形的價值，而透過智慧財產權的保護，他人無法以不正當的手段擁有或實行之。

二、智慧財產權之特性

智慧財產權具有「無體財產權」之性質，因其保護之標的為精神上創作之成果，屬獨立於有形物之所有權以外而且與物之所有權無關之權利，並由法律所特別賦予其專屬

性、排他性之權利，以實現其經濟利益。故其權利性質有別於傳統之有體財產權，權利移轉之方式亦有所差異。蓋傳統有體財產權在為所有權之移轉後即可為立即之使用與收益，但智慧財產權之移轉則不以有形物之交付為必要，其係透過技術讓與或技術授權之方式而為移轉，且在技術移轉後並無法為立即之使用與收益，該技術尚須經「技術商品化」(technology commercialization)之過程，藉由將該技術運用於生產之過程，使生產體系多樣化，進而提高生產力及創造更高品質之產品，如此方得以展現該技術之價值。再者，在技術移轉之過程中，若接受移轉之對象沒有足夠之技術能力、技術人才及技術移轉機制，其將無法完全吸收與消化該技術所包含之技術價值，以致無法有效運用該技術以創造最大之收益。故技術移轉與傳統有體財產之移轉有極大之差異，一般財產權法之規定並不一定均得適用，且其技術移轉之難度及所承擔之風險都明顯較大，在為移轉之考量時需做不同觀點之思考，方得發揮技術移轉所得創造之潛在價值。

國內學者對智慧財產權之特性提出許多不同之看法，其中李茂堂(1997)提出智財權具有四項特點：1、智財權的法律效力，在空間(地域)方面是有一定的範圍。2、智財權的法律效力有時間上的限制。3、智財權所保護的成果，通常是需要耗費大量的時間、資金、人力，也就是說需要很高的成本才產生出來的結晶，但是要侵害它，卻是輕而易舉。4、智財權的成立，通常需要經過一定的申請及審查【17】。而鄭成思(1991)則提出智慧財產權具有下列六項特點：1、無形性。2、專有性。3、地域性。4、法定時間性。5、公開性。6、可複製(可固定)性【18】。另外，劉尚志(1999)則認為智慧財產權具有以下特色：1、可阻止他人進入此產業，以提升產業競爭的能力。2、在智慧財產權的權利範圍與侵害判斷上不易鑑定。3、可使企業有靈活的策略運用，例如授權契約【19】。再者，李復甸及鄭中人(1999)則認為智慧財產權具有下列特性：1、不可分性。2、無排他性。3、無收取性。4、外部性經濟。5、不確定性。6、複製與傳遞成本低。7、價值的差異性【20】。

第二節 專利之基本概念

一、專利 (Patent) 的定義

最早的專利概念，根據記錄是出現在古希臘時代。可是現代的學者專家認為現代的專利法乃是基於英國1623年的「獨占法規 (Statute of Monopolies)」而衍生出來的【21】。「專利」一詞，從字面上看來，有獨享某種權力的意思。在英語系國家和德語系國家均稱其為Patent，惟發音上略有差別，而在日本，則稱之為「特許」。然依世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization; WIPO) 則將Patent解釋為：由政府所發給的一紙文件，其上載名某特定發明，並創設出一種法律狀態，使該發明僅得在文件上所指發明權人之授權下，方得利用之【22】。而國家詢議委員會 (National Conference Board) 依據美國法規法 (U.S. legal code) 則認為專利權是由一國政府所授予的特許，禁止非權利所有人在該國境內製造、使用，或是販售該項新發明的權利。專利權可能是針對某項新產品，也可能是針對某項產品的製造過程。侵害專利權被視為侵權行為或海盜行為【23】。

我國專利法開宗明義即表示其目的為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展【24】。其保護標的分成：1. 發明專利、2. 新型專利、3. 新式樣專利【25】。然在申請時，必須具備新穎性 (NOVELTY)、有用性 (實用性) (UTILITY) 及創作性 (非顯著性) (NONOBVIOUSNESS) 等要件，否則不予以專利【26】。而其權利存續期限分別為自申請日起算：1. 發明專利為二十年、2. 新型專利為十二年、3. 新式樣專利則為十二年屆滿【27】。在歸屬權方面，可將之分成職務及非職務二方面作探討。受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有訂定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。如一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權其專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未訂定者，屬於發明人

或創作人。若專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權【28】。

受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣。但受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。而雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。如其報酬有爭議時，由專利專責機關協調之【29】。

二、專利種類

專利乃是對於一項發明所授與之獨家權利，並對專利所有人提供保護，所謂發明是指可以提供新方法或是新的解決方案之產品或是製程。【30】在我國的專利法規定中，專利分為下列三種【31】：

1. 發明專利

謂利用自然法則之技術思想之高度創作。

2. 新型專利

謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。

3. 新式樣專利

謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。稱聯合新式樣者，謂同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。

表2-1 專利分類表

種類	專利年限	適合對象	法律依據
發明	20	方法、構造、裝置、材質	專19
新型	12	形狀、構造、裝置	專97
新式樣	10	外觀設計	專106

資料來源：專利管理高手，財團法人資訊工業策進會科技法律中心，2000.8

何孝元（1971）認為專利係以國家行政處分為內容之權力，屬於公權；但同時亦受到專利處分之期待權，故具有財產上之價值，因此亦具有私權之性質。就私權之性質而言，專利權乃支配專利對象之無體產權，故係絕對權與支配權，且專利權具有排他性的性質[註57]。陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇（1994）則認為專利具有兩項定義：1、發明人願意將其發明創作的成果公開出來與大眾分享。2、是人為創設而經政府賦予的權力，不是自然產生的天賦權力【32】。謝銘洋（1997）則認為發明專利係法律上對於發明所賦予之排他性權利，由於發明人在技術上有所創新，且願意將其技術公諸於世，以提升社會之技術水準，對於社會文明之進步有所貢獻，法律乃賦與其一段期間之專屬使用權【33】。

專利權係為一種排他權，不代表具有專有實施權，專利權人擁有排除他人製造、販賣、使用、或進口四種權利(專56)；專利權人應在專利物品或其包裝上標示「專利證書號」，否則，不得請求他人之侵權損害賠償(專82)；前項規定，若未有產品上市，實務上，專利權人還是可依法請求排除其侵害，有侵害之虞者，並得請求防止(專88)；請求排除之權利，自請求權人知其行為時起，2年間不行使即消滅；自侵害行為起逾10年者亦同(專88)；發明、新型、新式樣專利權之侵害糾紛僅具有民事及刑事賠償之請求；惟，發明糾紛不具有期徒刑或拘役之刑罰。(專88、89、123、125、126)；發明、新型、新式樣專利審定核准後有3個月之專利公告期，接受公眾審查；期滿順利始發專利證書(專

47)；專利公告期間「暫准」發生專利權之效力(專50)；發明與新型專利之審查標準分野在於發明專利之技術改良係為水平較高者(專19、20、98)。

三、專利獲得之優點

專利在企業技術發展的活動範圍中，未來將成為企業經營戰略的重要因素；由專利制度所延伸的專利情報、專利權之取得與活用，對於防衛性專利與專利侵權之對策等各種專利的機制，更需透過企業有系統地實施，而成為現代企業之專利管理。而其獲得專利之優點，大致上來區分可有以下3點：

(一) 專利對產業界的價值

國內產業技術不斷提昇，加上台灣發展成為科技島已是政府既定之目標。而權利金追索及專利權糾紛，現嚴然已成為國內廠商的夢靨。因此，專利對現階段國內產業有極大之價值，茲分別描述如下【34】：

1. 專利可保護研發成果
2. 專利可提高單位績效
3. 專利可創造利潤，維持競爭優勢
4. 專利對企業未來發展，具絕對的影響力

(二) 專利對研發的重要性

祈明輝(1999)認為專利對研發的重要性如下【35】：

1. 就文字意義而言：獨佔性質、獨享性質。
2. 民國八十三年修正專利法時，特別將立法之目的明列為第一條條文：「為鼓勵、保護(a)、利用發明與創作(b)，以促進產業發展(c)，特制訂本法」。
 - a. 專利權可以保護研發成果【36】。
 - b. 專利權可以促進研發腳步：
 - c. 專利權是永續經營的策略，國際經濟貿易的籌碼：

(三) 專利是產業發展的指標：

國科會光電小組執行秘書石先生認為光電科技每天至少都有100 個專利出現，可繼續推動國內光電產業發展15 年。根據世界智慧財產權組織（WIPO）統計報導，善加利用專利資訊，可以縮短研發時間60%，節省研發經費40%，尤其是經濟不景氣的現在，降低研發成本實是一重要的考慮因素。專利權的獲得乃在取得客戶信任與肯定，增加對研發產品的信心，提昇公司形象，創造公司利潤，維持公司持續成長。

對公司而言：

i. 進可攻：

現今許多國外企業均先藉由專利權卡位後，再經由訴訟方式來迫使國內業者付出權利金。

ii. 退可守：

- 保護：避免產品侵權。
- 販賣：王安公司之專利銷售以獲利，原本面臨破產邊緣，後來公司重整，改為服務公司，而再生產與販賣。
- 授權：取得權利金。
- 交互授權：以獲得產品保護傘。

一般而言，目前企業致力於專利權的獲取可以得到以下的優點及好處：

- 1 防止他人或他公司之侵權仿冒
- 2 提升公司及專利產品之整體形象
- 3 砥礪公司之研發風氣及水準
- 4 累積公司資產，厚實談判籌碼
- 5 交付授權，為公司開源創造利潤
- 6 檢閱競爭對手之研發策略及版圖
- 7 掌握關鍵技術，阻礙競爭對手進入領域
- 8 作為它日非故意侵害之佐證依據

專利權不但可以保護發明人創作的心血，對公司及組織而言更是生存、競爭的工具。根據世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)的報告指出，公司及組織善加利用專利資訊，不但可縮短百分之六十的研發時間，更可節省將近百分之四十的研究經費。往往一個關鍵性的專利，就足以讓一家公司身價暴漲，也足以讓一家公司破產。專利制度設置主要目的是由國家賦予專利的壟斷權，鼓勵創造者公開發明，使他人得以對此發明可以再利用或再開發，以提升整體社會之技術進步。

四、專利管理

專利是科技與法律的介面產物。專利管理可以分為四個階段（如表2-2），四個階段之功能執行需以公司之整體策略為考量並與公司各部門相配合【37】。(1) 第一個階段為「專利申請」，在申請專利累積中，更應追求量變產生質變，提升專利的品質。(2) 第二個階段是建立專屬的專利資料庫，作為企業內部技術文件的來源，也同時作為監視其他企業技術發展的工具，以公司的技術為基礎，定期由專利公報中收錄與自己有關的專利文件，同時依公司的技術項目加以歸類，除了可提供科技人員查詢外，也可依此判斷公司產品與製程技術是否與他人專利有抵觸之情事，如發現某些專利權的獲得有疑義時，為了保障公司的權益，避免未來訴訟的糾紛，通常須將這類專利作更進一步的調查與分析，必要時則進行異議或舉發，以撤銷他人專利。(3) 第三個階段為專利趨勢分析及研發策略擬定之階段，專利地圖的製作可以提供決策所需之相關資訊。(4) 第四個階段則為公司之專利進行組合管理，建構專利網。

表2-2 專利管理四個階段

階段	管理態樣	功能/ 目的	基本要件
	專利申請	1. 防止侵害： (1)法律保護申請 (2)市場產品監視 2. 技術授權	1. 專利評估— (1)可專利性（新穎、進步、實用） (2)產業價值（實施難易、成本、市場） 2. 專利品質：保護範圍最大化 3. 迴避之可能性（難易度） 4. 申請及維護之成本
	專利資訊 管理	避免侵害他人 監視、異議、舉發 先前技藝調查 技術資料庫	專利檢索工具/檢索策略 技術分類 資料庫建立/更新 迴避設計/侵害
	專利分析	研發項目規劃/研發專案管理 技術趨勢分析 技術競爭分析 基本專利辨識	專利分析技術/專利地圖 其他技術資訊（動、靜態）
	專利網/ 專利佈署	基本專利/週邊專利設定 攻防策略與資源分配 授權策略/目的	產業競爭分析 SWOT 分析

資料來源：劉尚志等，產業競爭與專利策略，科技發展政策報導，2000.8

林大器（1998）認為專利的管理包括「產出管理」及「運用管理」。產出管理是指如何運用公司內部或外部的資源（包括人力、金錢等資源）來產生專利；而運用管理則是如何運用自己的專利防止他人侵害，或是如何運用自己的專利，與他人進行交互授權談判，其專利產出管理的部分如圖2-2 所示【38】。

然在專利的實際運用可分為幾方面【39】：

1. 商業利益（市場行銷）：將專利號用於廣告中或印刷於廣告產品上，把此項專利技術當作行銷工具般常使用。
2. 防衛性使用（提供操作的自由）：公告的專利與審查中的專利標記，可以幫助避免拷貝技術的競爭者及得到可能覆蓋未來產品專利的競爭者。
3. 授權及交互授權：專利常能產生授權收入或是做為與競爭者交易的工具。
4. 在專利的地理涵蓋範圍方面：現今專利權人已漸漸明瞭應在需要保護的地區申請，如製造地或銷售地，或者可能再加上未來市場，另外需考慮到的是當地法令的執行度。

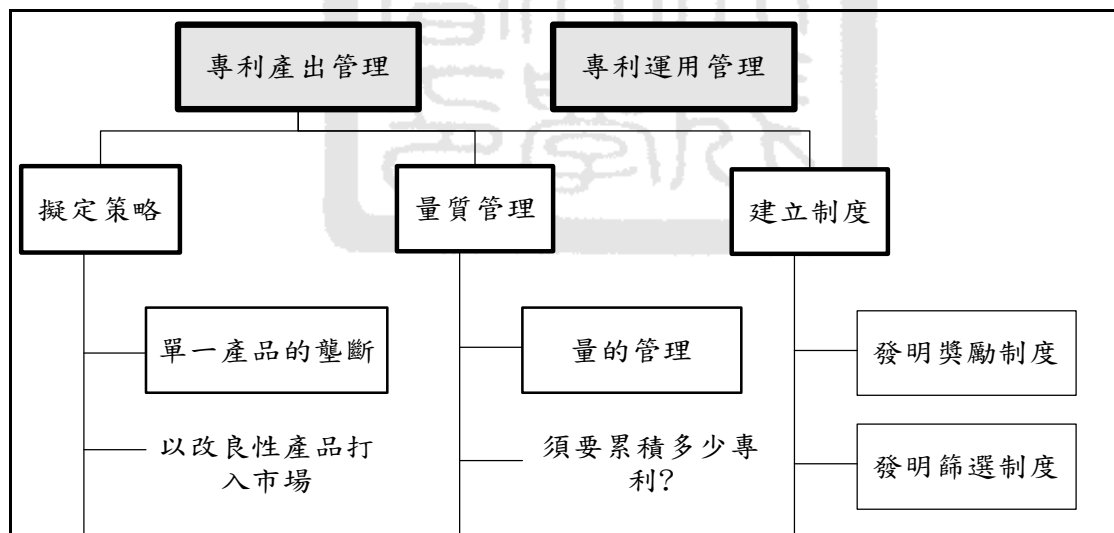


圖2-2 專利管理制度

資料來源：林大器（1998），「建立更有效的專利管理制度」

五、專利分析

專利分析就是將專利資料轉換成更有價值的資訊，是科技研發規劃與智慧財產權管理的有效工具，可作為科技競爭分析、科技趨勢分析以及權利範圍判斷。【40】產品研發工作中，如果先做好專利分析的工作，即可對目標技術或產品建立完整的資料庫，作為日後產品創新及迴避設計的依據。美國著名專利分析研究者Mary Ellen Mogee認為專利分析結果具有下列應用價值：

1. 競爭對手分析 (Rival Analysis)

專利文獻中有專利分類號，不同的專利資料庫有其分類的方式。相同種類的發明會分類在同一個群組之下，利用專利分類號的搜尋可以立即掌握相同種類發明的專利申請情況，利用此資訊，可以掌握競爭對手的專利申請情形。

2. 技術追蹤及預測 (Technology Tracking and Forecasting)

鎖定特定技術的專利可以判斷出哪些技術逐漸成熟即將進入市場，哪些技術已經成熟無法突破。

3. 掌握重要之技術發展 (Identifying Important Developments)

特定研究單位或公司的專利數量僅能說明投入了多少的研究申請了多少數量的專利，欲瞭解哪一個專利為最重要最關鍵的核心技術，可以從引用關係分析來得知，一個具有關鍵技術的專利，將會成為後面相關發明專利的引用對象。

4. 國際專利策略分析 (International Strategic Analysis)

利用專利資料庫，以得知特定公司在世界各國的專利申請情形，由此可以判斷該公司欲在這些申請專利的國家進行商業行為。另外，美國專利分析研究者Leonard Berkowitz認為專利分析資訊具有下列應用價值：

1. 瞭解發明 (Recognition of Invention)

2. 發明之記錄 (Recording of Invention)

3. 申請專利決策之參考 (Filing Decision)

4. 專利搜尋 (Searches)
5. 個案策略分析 (Case Strategy)
6. 申請專利案件之草擬與修改之參考 (Case Drafting and Revision)
7. 申請外國專利之參考 (Foreign Filing Prosecution)
8. 監控公佈之專利 (Monitoring Issued Patents)
9. 聲明異議 (Opposition)
10. 專利維護 (Maintenance)
11. 強制執行 (Enforcement)

而擁有相關技術之專利分析資訊，對於公司企業有下列重要意義【41】：

1. 可瞭解技術現況與事實，避免浪費時間金錢重覆他人之研究或抵觸他人之專利權。
2. 可預測未來的發展，正確的運用專利技術加速開發創造。
3. 在摸索研發方向時，藉由閱讀探究前案專利之創新特徵及技術精髓，可以累積技術新知及研發能量，以啟發創意靈感。
4. 先前專利之調查、分析及利用，乃產業評估技術可行性或預測未來技術以設定科技策略時，最客觀、具體且有效工具之一，可有效迴避他人專利，並預測自己開發自主性技術取得專利權之可行性。
5. 在研究開發階段可避免重複研發，並可參酌先前專利適時修正研發藍圖，決定研發資源最佳分配模式，部署最有利之專利權戰略網。
6. 從事申請專利階段時，可監控先前專利動態，以設定自己研發計畫，可以使整個研發過程之專利成果，完全在規劃及掌控中產出，有助於專利申請取得及權利範圍之設定。
7. 在產品上市後，積極面藉由專利權護駕可確保競爭優勢，獨享市場利潤，排除對手公司之仿冒跟進，消極面可保障產品之製造、銷售或技術移轉之活動自由度，有效降低侵害他人專利而遭致索賠之風險。
8. 專利之調查及分析結果，有助於選定適合之技術來源者或合作者，並可針對合作對

象進行完整之專利地毯式搜索，以為授權契約談判之有利籌碼。

第三節 積體電路布局保護之基本概念

最近許多先進國家紛紛針對半導體積體電路的布局設計訂立特別法案而加以保護，因為著作權法只可保護晶片中ROM 所含的程式或微碼，但並不能保護晶片產生過程中的另一重要步驟-布局設計。我國參酌先進國家之法例，並依據TRIPs 有關規定，自民國78年起即積極草擬「積體電路布局保護法」，終於在民國84年7月13日經立法院三讀通過，並於民國84年8月11日經總統令公布，於民國85年2月11日起施行【42】。

根據我國積體電路布局保護法第二條，所謂積體電路係指將電晶體、電容器、電阻器或其他電子元件及其間之連接線路，集積在半導體材料上或材料中，而具有電子電路功能之成品或半成品。積體電路布局指在積體電路上之電子元件及接續元件之導線的平面或立體設計。惟保護範圍僅及於與積體結合之電路布局或尚未結合之電路布局，其餘在印刷電路板上之布局圖，並不受積體電路布局之保護，必須另尋著作權保護。

我國積體電路布局保護法開宗明義即表示目的為保障積體電路布局，並調和社會公共利益【43】。其申請必須具備原創性。而權利存續期間為以登記之申請日或首次商業利用之日較早者起算10年為限。在歸屬權方面，可分成職務或非職務上二方面。受雇人職務上完成之電路布局創作，由其雇用人申請登記。但契約另有訂定者，從其約定。若出資聘人完成之電路布局創作。准用前項規定。前二項之受雇人或受聘人，本於其創作之事實，享有姓名表示權【44】。

第四節 高科技產業

一、高科技產業之定義

一般而言，高科技產業有數量化及概念化定義兩種分類【45】。

1. 數量化定義：

Boretzky (1982)認為高科技產業乃是研究發展費用佔總收入10%以上者，或員工中有10%以上為科學家、工程師及技術專家者【46】。而美國國家科學基金會(NSF)(1981)則認為研究發展費用佔銷售額3%以上，且產品變化迅速者為高科技產業【47】。另外，美國勞工統計局(BLS; Bureau of Labor Statistics) (1983)則以研究發展費用比例和技術人員比例為全美國製造業平均數二倍以上者為高科技產業【48】。

2. 概念化定義：

Kelly (1974, 1977)認為以產品之研究發展費用與售價之關係來定義「技術密度」，依大小順序排名：排名前四分之一的產品列為高科技產品(1974)，爾後則是改排名前二分之一的產品為高科技產品【49】。Davis(1982)認為利用「投入-產出分析」以一組產品代替單一產品衡量「技術密集度」，也就是只有商品有較高的研究發展密集度即為高科技產品【50】。Riggs(1983)則認為高科技產業應具有三項基本特徵：(1)產品的生命週期短，甚至只有五年而已。(2)需要工程師高精密性的工作研發。(3)具有經濟上的風險性【51】。Bleicher & Paul(1983)則以技藝水準 (the state of art) 來界定高科技，所謂的技藝水準乃指行業中最尖端 (frontier) 的科技而言【52】。Rogers & Larsen(1984)認為高科技產業應具備四個條件：(1)科學家及工程師佔技術員工比例很高。(2)產業本身成長的速度很快。(3)研究發展費用的支出占營業額很高的比例。(4)產品的市場是世界性的【53】。Riggs(1985)則認為高科技產業應具有四項基本特徵：(1)大量的工程師與科學家僱用於企業組織中。(2)產品的生命週期短。(3)產業具有風險性 (主要來自於產品的觀點)。(4)產業快速的變化、不穩定 (不管是朝向發展或走向衰退)【54】。Carnoy(1985)

以三項準則來區別高科技產業：(1)先進技術、知識之專業員工佔全員工比例為工業平均值的1.5 倍以上。(2)先進技術、知識之專業員工所佔比率較傳統產業

二、高科技產業之特性

嚴永晃(1984)認為高科技產業有下列四種特性：1. 技術開發速度快，需大量研究發展，研發支出占營業收益或附加價值比例高於總平均值，而且大部分經費由政府或公共部門支出。2. 高科技產品大多為整個經濟體系所廣泛使用，「規模經濟」的重要性大。3. 高科技產品大多為「生產財」或「資本財」，其營業額中有相當大比例依賴政府部門之公共採購。4. 高科技產業各部門，特別是零件生產與裝配場之技術，依賴程度較一般工業部門高，「產業體系」的完整性很重要【55】。

江炯聰(1984)則認為高科技產業具有的特性為：1. 市場成長率高，產品生命週期短，潛在市場規模小，易被高機能新產品所取代。2. 隨著累積產量的提高，成本下降十分迅速。3. 晚一步進入市場的企業常面臨過渡競爭的局面而陷入苦戰。4. 對個別廠商而言，市場進入障礙相當高【56】。

陳以玲(1985)認為高科技產業的特性為產品複雜且生命週期短【57】。毛治國(1985)則認為高科技產業之特性有三：1. 有關產品及製程的科技是其基本戰略武器。2. 發明及創新是生存的關鍵。3. 因科技得不斷發明與創新，故不論是產品或製程的生命週期均極短促【58】。曾銘深(1986)則認為其特性有二：1. 技術複雜且進步速度快。2. 市場競爭激烈、變化快，不確定與風險性都很高【59】。劉瑞圖(1988)則認為其特性有下列幾種：1. 高科技產品市場變化非常快，生命週期短，規格經常變更，市場競爭劇烈，對主要零件的掌握非常重要。2. 具有高風險性、高利潤、進入行業時機非常重要。3. 對科技人才的掌握非常重要，以人才為本，公司對科技人員的管理要強調有機式的方法給予關心、體恤、鼓勵與其發揮潛力；重視科技人員的知識技能與技術水準。4. 產品品質要求嚴格，有高精密度和信賴度。5. 高科技產業利用的是科技人員共同研究的成果，重視團隊合作創造，集合眾人的智慧共同研發。6. 重視專利權及著作權【60】。鄧朝貴(1994)將高科

技產業的特性歸類為：1. 產品的生命週期比傳統產業的產品生命週期要短。2. 高風險、高利潤的行業。3. 注重創新、發明與研究發展。4. 技術的開發速度迅速，對技術的依賴性很高。5. 企業所處的環境變化迅速。6. 重視專利權與著作權。7. 對科技人員的管理方法異於傳統製造業。8. 以專業技術為取材的標準。9. 創業者通常為二至五人的團隊合作組合。10. 產品的信賴度和精密度要求嚴格【61】。Bollinger, Lynn&Katherine (1983) 認為高科技產業有三個特性：1. 往往是2至5人的創業團隊。2. 專業技術是選才的標準。3. 成功的高科技公司特別重視人事【62】。Shanklin&Ryan (1984) 認為高科技產業的特性有二：1. 發明和創新是高科技產業生存關鍵。2. 高科技產品的推出，主要是由科技本身的推力及需求的拉力二種力量所導引【63】。Mar, Newell &Saxberg (1985) 則認為其特性為：1. 大部分的產品均仰賴創新及新技術。2. 由於技術發展迅速，導致產品生命週期縮短。3. 技術研發人員缺乏。4. 競爭者多、顧客需求多樣化使得競爭環境複雜【64】。

綜合上述各位專家學者所提出高科技之定義及特性，可端倪出隨著時代的演進，高科技的定義也隨著演變。無論是以數量化或者是以概念化來定義，由於科技的發達及產業快速的提昇，要求的條件及特性也更嚴謹。

第五節 專利權範圍及其解釋

一、何謂專利權

所謂專利權，乃專利權人專有製造、販賣、使用或進口其發明之排他權【65】。由於專利權具有無形性及公共性之特徵，必須透過媒介物而表現，而權利本身乃一概念上存在而以文字元號抽象表達而界定【66】。而該界定即為專利說明書上所載之申請專利範圍部份。在用語上，依美國專利法第一一二條稱之為「claim」；德國法第二十六條第一項稱之為「Gegenstand（應受專利法保護之對象）」；歐洲專利公約第六十九條亦稱之為「claim」；日本特許法第七十條稱之為「特許發明の技術的範圍」；而我國專利法第五十六條第三項用語為「專利權範圍」。雖各國在用語上不盡相同，然其所指者皆為專利權範圍。

國內有學者以為：「申請專利範圍是專利實務的一個特產物，因為它的存在而使專利說明書不僅是技術文獻，同時也是權利文獻【67】」二者之交互配合作為決定專利權權利範圍之基礎。由歷史發展【68】中，早期說明書制度存在目的並非是為使公眾知悉發明內容，而是單純的做為獨占範圍明確化的手段。雖最早之說明書制度於一七一一年出現於英國，然僅透過說明書所載之事實來推定專利權範圍，對於「申請專利範圍」之記載仍非必要。而美國在專利制度之發展雖較英國晚，但其發展卻較成熟，美國在一七九〇年所制訂之專利法要求申請人須針對新舊技術作區別之要求，並於一八三六年之修法將「申請專利範圍」(claim)加以概念化及明文化。故在瞭解專利權範圍前，須先就說明書及申請專利範圍二者分別來加以說明：

(一)、說明書

專利說明書者，乃發明人向主管機關所提交之請求專利文件，亦為主管機關審查之基礎，具有定專利技術公開及在專利權範圍內具有排他權利之雙面意涵。為達技術公開目的，說明書之撰寫須使熟習該項技術者能夠瞭解其內容並據以實施。依據專利法第二十

二條第三項「...說明書，除應記載申請專利範圍外，並應記載有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」。依我國專利法要求即所謂充分揭露原則，可簡析如下：

(1) 熟習該項技術者：揭露之內容必須使熟習該項技術者能瞭解其內容，所謂熟習該項技術者係指熟習該發明所揭露相關技術領域之一般技藝知識人士。

(2) 表達須達能瞭解內容：有時說明書之揭露可能足以使熟習該項技術者據以實施該發明，但卻仍無法符合文字描述的要求。對於文字描述的要求，申請人的說明一定要合理地表達讓熟習該項技術者瞭解該申請人發明瞭什麼，以及主張了什麼。

(3) 依據說明書能實施其發明：說明書之揭露程度應使熟習該項技術者可據以實施該請求保護的發明，除非熟習該項技術者不需說明便能知悉。

(二)、申請專利範圍

所謂申請專利範圍者，在概念上申請專利範圍猶如土地外圍之柵欄。專利的權利範圍之界定，依現行各國立法例，主要根據專利說明書上所記載之專利申請範圍 (claim) 決定。由於申請專利範圍界定了專利權範圍；因此，各國相關專利法對其申請專利範圍記載方式【69】及內容【70】皆有明確規定。以我國為例，專利法第二十二條第四項「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」而申請專利範圍之記載要點依據專利法施行細則第十六條規定「申請專利範圍，應依下列各點記載之：1. 申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示，其項數應配合發明或創作之內容，必要時，得有一項以上之附屬項。2. 獨立項(independent claim)應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。3. 附屬項(dependent claim)應包括所依附項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點。4. 依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。5. 附屬項得以其他附屬項依附敘述之。但多項附屬項間不得直接或間接依附。6. 以多項敘述者，每一項目應以數字序列，獨立項、附屬項以其依附關係序。7. 獨立項或附屬項之文字敘述應以單句為之，其內容不得僅引述說明書之行數或圖式之

元件符號。」除上述之獨立項、附屬項外，在說明內容結構上有所謂的前文(preamble)、過渡片語(transitional phrase)、請求主文(body of claim)及機能子句(whereby clause)等專門記載方式【71】，此一結構化方式說明權利請求項【72】，實有助於達到確定專利權範圍之目的。

在審查申請專利範圍之請求項時須考量【73】：(一)請求項中的用語及辭彙，以適當地判定申請專利範圍中所使用辭彙之意義；(二)認定每一專利請求項的限制。對於主張方法發明者，其專利請求項應限定在所執行的步驟或程式。對於主張物之發明，其專利請求項則應限定為確切的具體結構，以確保正確地認定每一專利請求項所指範圍；(三)從熟習該項技術者的觀點來理解申請專利範圍；(四)申請專利範圍應視為一個整體(as a whole)來考慮周延。由於發明或創作之內容須透過抽象文字表達，為有助具體落實，因此在美國法上又衍生出所謂手段加功效之記載。依我國智慧財產局於八十七年十月所公布之「特定技術領域之電腦軟體相關之發明審查基準」之定義：「所謂功能手段語言(Means or Step Plus Function Language)係針對請求項為組合式元件(elements)之描述方式，在撰寫申請專利範圍時，能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作(acts)之情形下，以一種實現某一特定功能之裝置(means)或步驟(step)的方式來表示之。使用此種格式的撰寫方式將可省略結構上或程式上所需的複雜說明，而使申請專利範圍的撰寫可大幅地簡化【74】。」亦引入此一概念【75】，惟並未於專利法明文承認。專利權人所得主張之權利範圍相對於侵權行為所能主張之保護範疇，二者均係由申請專利範圍(claims)加以界定。就大多數之專利侵害案件而言，透過抽象的文字解讀以研判專利範圍是否涵蓋專利權人認為害其專利權之涉嫌物品或方法，常有因解釋方式不同，涉嫌仿冒者可能獲得主張未構成侵害之空間。因此如何解釋專利權範圍，在「侵害」與「未侵害」之間劃出一條界限，便顯得非常重要。

二、專利權範圍解釋

說明書上申請專利範圍之文字記載通常僅記載專利的必要構成元件，其「實質內容」應參酌說明書及圖式所揭示的目的、作用及效果而加以解釋之。分析申請專利範圍的目的，是要認定申請人所訴求之專利權範圍，並瞭解申請專利範圍與申請人之發明的關係。依現行國內外學說及實務見解，專利的技術保護範圍應基於專利說明書之申請專利範圍而為判斷，亦即申請專利範圍是確定專利權範圍及其保護範圍之直接依據。解釋申請專利範圍之順序可歸納如下：1. 應以申請專利範圍中所描述的內容為準：非以文字記載為準。如說明書記載之創作範圍廣於申請專利範圍時，原則上應僅能以申請專利範圍定其技術範圍；申請專利範圍應記載創作必要構成要件(elements)之全部利範圍內記載複數要件時，不得就複數要件其中之一，主張獨立的技術範圍；2. 參酌說明書、圖式：申請專利範圍只是專利說明書所記載必要構成（不可欠缺）事項之簡潔記載，故為明確申請專利範圍所表示之實質內容，應當要參考說明書及圖式，包括創作構成要件之技術用語，創作之目的、功效、特點以確定技術範圍；3. 參酌申請過程及相關主張：（類似禁反言原則(File Wrapper Estoppel)）專利權人在專利申請過程中，為因應審查員(Examiner)的審查意見、核駁理由或第三人之異議理由，對自己的發明內容作某種自我設限，或為明確發明之特徵，就申請專利範圍或說明書，作補正或闡明時，當然不能在取得專利後，就限定補正或闡明前之技術範圍主張權利；其次，專利權人於申請說明書上將請求專利範圍之際有意的將說明書所載之創作事項排除於申請專利範圍之外，則該排除事項不屬於專利之技術範圍；又專利權人倘將其創作之申請專利範圍限於特定事項而排除其他事項，則專利之技術範圍僅限定於該特定事項上。

現行國際通行之解釋申請專利範圍原則可分為中心限定主義、周邊限定主義及折衷式周邊限定主義三者，其內容如下：

（一）、中心限定主義

此說觀點認為創作本身是屬於一技術思想，而申請專利範圍所記載之文字內容僅係將抽象思想作一具體化忠實描述，並記載發明特質之典型例，故創作所及保護範圍並非止於申請專利範圍之文字記載而已，而係以「申請專利範圍」為中心，承認在外側尚有一定範圍之擴張空間，應得以某一程度之延伸解釋【76】。說明書所記載之申請專利範圍乃一項專利最起碼的權利範圍。專利保護範圍係以申請專利範圍為中心而以一定程度向外側延伸。在解釋上專利權範圍可參酌說明書、圖示等由法院自由認定。

（二）、週邊限定主義

週邊限定主義之理論依據乃針對專利性質採用契約說來加以解釋，即認為專利乃發明人與公眾之間就發明實施獨占權範圍所簽訂之契約，而申請專利範圍正是此項契約之事項條款。故專利獨占範圍只涵蓋已描述於說明書並定義於申請專利範圍之事項，故理論上應不得利用均等論之主張將權利範圍做擴充之解釋。申請申請人所欲主張專利保護之創作範圍，擴張解釋則不予承認，凡是不包含於申請專利範圍內載於說明書上之技術內容，乃為專利權效力所不及。

（三）、折衷說

採週邊限定主義，其權利範圍一目了然對社會安全性有相當保障。惟專利權人於申請時難免有用字遣詞疏漏及面對有意侵仿冒者透過相同功效技術方法迴避專利時，無法有效保護專利權。是以折衷說原則上主張專利保護範疇係根據「申請專利範圍」之內容來加以確定，而說明書及圖式則用來解釋申請專利範圍，很明顯的，折衷說之見解介於中心限定及週邊限定主義之間而採中庸之道，已逐漸形成各國解釋申請專利範圍之主流。

三、專利權範圍及專利權保護範圍之區別

依現行制度，專利權範圍之認定係以說明書上所記載之申請專利範圍為準，以下便以我國法律為例分別針對「專利法上權利保護」、「專利權範圍」、「專利權效力範圍」及「專利權保護範圍」作區分：

(一)、專利法上權利保護

即現行專利法上明文承認之權利類型，可歸納有下列種類：

(1) 專利申請權：指得依專利法申請專利之權利。第五條「稱專利申請權，係指得依本法申請專利之權利。」

(2) 優先權：依專利法第二十四條「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次提出申請專利之次日起十二個月內，向中華民國提出申請專利者，得享有優先權。如申請人於一申請案中主張兩項以上優先權時，其優先權期間自最早之優先權日之次日起算。至於申請人為外國人者，以其所屬之國家承認中華民國國民優先權者為限。同樣的如有主張優先權者，其專利要件之審查，應以優先權日為準。主張優先權之申請人，應於申請專利同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日、申請案號數及受理該申請之國家。申請人應於申請之日起三個月內檢送經該國政府證明受理之申請文件，包括說明書、必要圖式、申請專利範圍及其他有關文件。未於申請時提出聲明或逾期未檢送者，喪失優先權。」

(3) 專利權：即專利權人依專利法所取之法定權利，內容上以專利權人專有排除他人，以製造、使用、販賣、陳列、進口為手段之獨占實施權為主，僅具財產性而非具有人格性，類型規範於專利法第一二三至一三〇條。

(4) 質權：第六條「專利申請權及專利權均得讓與或繼承。」「專利申請權，不得為質權之標的。」「以專利權為標的設定質權者，除契約另有訂定外，質權人不得實施該專利權。」由於專利權在性質上亦為財產權之一，故專利權人亦得處分其權利。

(5) 損害賠償請求權／侵害排除請求權／侵害防止請求權：第八十八條第一項「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」「專屬被授權人亦得為前項請求。但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限。」

(6) 姓名表示權：發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回

復名譽之必要處分。兼具財產權與人格權性質。

(7) 進口權：現行專利法第五十七條第一項第六款：「六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。」

(二)、專利權範圍

專利權範圍者，即為專利權人所得主張其專利權之技術範圍，依第五十六條第三項「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」第一〇三條第二項「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」第一一七條第二項「新式樣專利權範圍，以圖說所載之申請專利範圍為準；必要時，得審酌創作說明。」基本上三者所指之範圍皆相同。申請專利範圍為專利實務之核心，亦為專利權人主張權利之基礎，和專利權範圍有密不可分之關係【77】。

依現行專利法第五十六條第一項「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」第二項「方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」第一〇三條第一項「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」第一一七條第一項「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。」專利權人得主張就專利權範圍內之技術，在實施上，以製造、販賣、使用及進口為類型；在消極排他性上，得排除他人就同一專利之實施。特別提出者，新式樣專利權之範圍亦因明文新式樣專利權人得排除他人就近似新式樣專利物品之進口而較發明專利及新型專利之專利範圍為廣，亦即，發明與新型專利權之權利範圍乃申請專利範圍；而在新式樣專利權之專利權範圍不僅在專利權人之申請專利範圍，並擴及於相近似之新式樣。故只要通體觀察形狀相同或近似者，

均為該新式樣專利權範圍所涵蓋【78】。

(三)、專利權效力範圍

專利權之效力，即為專利權人在其保護範圍內所得享有之權利。由於專利權人得主張於專利權範圍內為專有製造、販賣、使用或進口其發明之排他權利。即在效力上，如物權私之支配權，具有直接實施其權利內容之積極效力及排除他人干涉之消極效力。但專利權範圍並非絕對等同於專利權效力範圍，亦即在法定狀況下，在專利權範圍內專利權效力仍受到限制。

就我國法而言，係採明文規定方式，即在（一）暫準專利：依第五十條第一項「申請專利之發明，經審定公告後暫準發生專利權之效力。」第一百條新型專利及第一〇九條新式樣專利亦同；（二）撤銷專利：第七十四條第二項「發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。」；（三）專利權效力之例外：第五十七條第一項「發明專利權之效力不及於下列各款情事：一、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。二、申請前已在國內使用或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。三、申請前已存在國內之物品。四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。五、非專利申請權人所得專利權，以專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。」，第一一八條「新式樣專利權之效力不及於下列各款情事：一、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其新式樣，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。二、申請前已存在國內之物品。三、專利權人所製造或經專利權人同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。」

(四)、專利權保護範圍

所謂專利權保護範圍，係指專利權人根據其所取得之專利，所能受到法律保護之範圍。

就無體財產權之本質而言，由於無體性，故須藉由媒介以具體表彰其權利，由抽象文字以界定其權利範圍。基於上述原因，所有的無體財產權應就其本身之獨占實施權外另具有保護範圍。

第三章 研究方法及流程

第一節 研究限制

本研究雖然盡力追求資料的完整，但時間及環境隨時在變，要隨時掌握正確的資料並不容易，難免會有疏漏。在考量主、客觀的因素之下，本研究有以下的限制存在：

一、專利的限制

專利為一項已公開並易於取得的資料，在成為專利之前的各項技術創新有可能申請並未核准、或作為企業的營業秘密等其他未公開的發明創新，這些因素都會造成資料收集不易及認定困難的問題，所以由上述因素所產生的影響並不在本文中加以考慮，而僅以公開的專利資料做為討論主題的背景資料。

二、以國內專利事務所為對象的限制

本研究是以採用中華民國專利公報資料庫的資料為主體研究對象，其中代為申請專利的專利事務所眾多，本研究是取目前國內申請件數較多的前三大專利事務所所申請的專利案件為分析對象

三、說明書研究觀察數較少

本研究是針對專利說明書撰寫模式來加以分析的，其中在對於判斷專利說明書內所敘述之專利特徵並不容易，所以只針對前三大專利事務所各任選三份專利說明書來加以分析及研究。

第二節 研究流程

一、研究流程

本文的各項研究流程定義：

1. 研究動機及目的：探討本文初期的興趣及所欲達成的目標。
2. 確認研究問題及方向：在目標確立後找出著手點並進行探討。

3. 文獻探討：尋找相關資料來進行理論與實際的支持與探討。
4. 資料選擇：決定資料搜尋及選取的對象以及資料的限制。
5. 資料收集、整理：尋找研究所需資料來作歸納、整理，並對資料作初步的篩選動作。
6. 資料分析：將資料根據邏輯推理及分析，推論出問題的答案。
7. 結論與建議：根據研究的結果歸納出結論，並對未來相關研究發展方向提出具體的建議。

本研究流程圖則參照圖3-1：

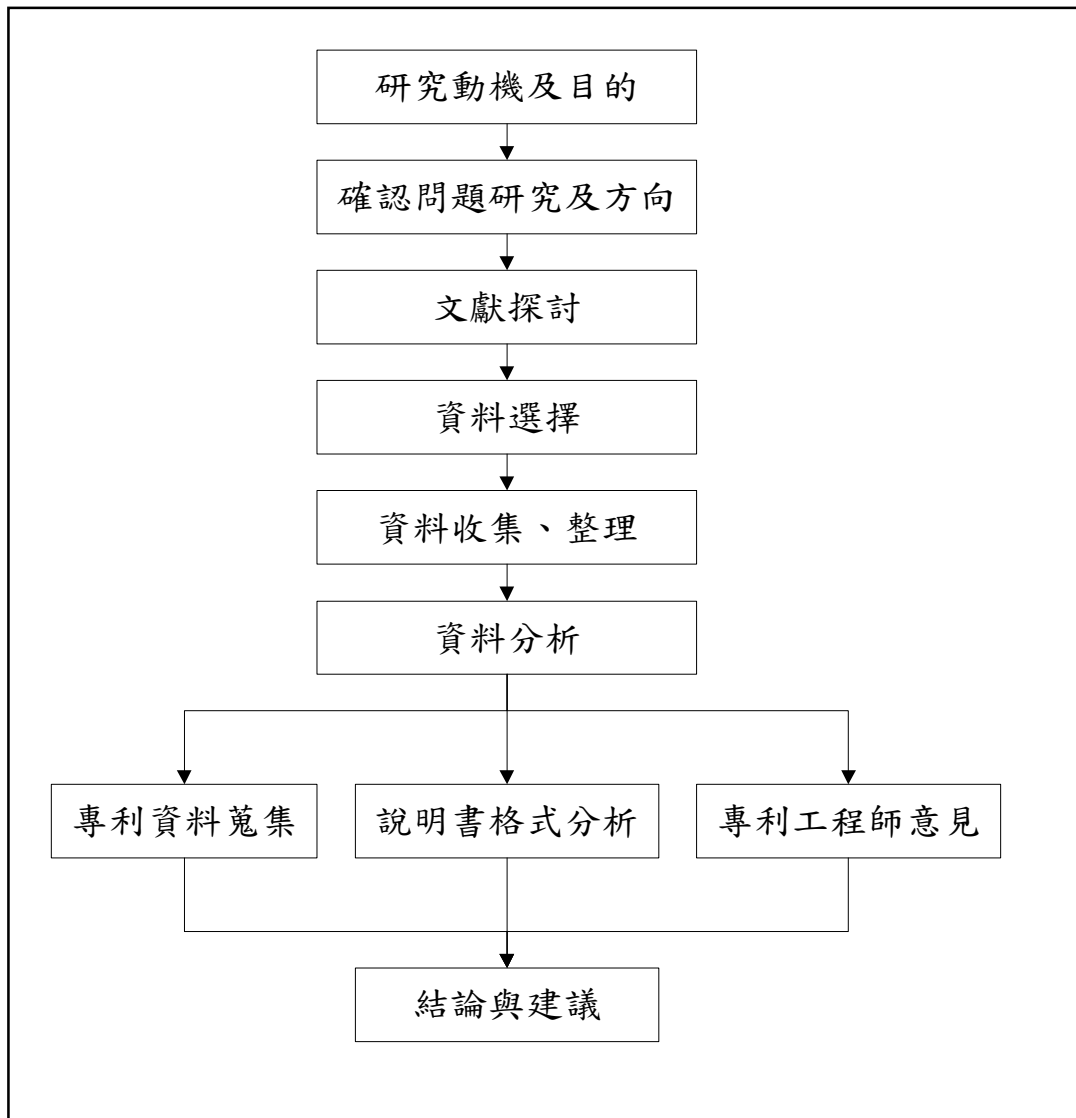


圖 3-1 本研究流程(資料來源：本研究整理)

第四章 專利申請模式分析

第一節 專利檢索方法

專利文獻檢索主要可按照專利分類索引或專利權人索引來檢索，以及電腦檢索等方法。

一、專利分類檢索

各國分類表，主要是按照本國的分類體系將各種發明、技術主題分層次地分成大類、小類、或部、分部、組、分組等排列的。國際專利分類號（IPC，International Patent Classification）是目前國際共同使用的一套編碼方法，其主要功能在於促使專利資訊的流通更順暢。此分類號係透過五種階層：部、類、次類、主目及次目等五種階層。各階層介紹如下表4-1

至於美國專利分類號（UPC，United States Patent Classification）則是美國專利暨商標局所編制463 類（class）以及108,000 次類（subclass）的專利分類表。此分類依兩階層來對專利做區分，各階層均以數字表示。經由USPTO 查詢專利時，並無法立即判斷欲查詢之技術落在哪一個分類之上，所以必須將關鍵詞句透過USPTO 網站所提供的「Simple Text Search Across All U.S. Patent Classes in the Manual of Classification」先找出該技術所在的分類，以利進行後續的搜尋。

表 4-1 國際專利分類號

五階	內容	數目
部 (section)	A (Human necessities) B (Performing Operations; Transporting) C (Chemistry; metallurgy) D (Textiles; paper) E (Fixed construction) F (Mechanical engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting) G (Physics) H (Electricity)	8
類 (class)	部之下分為若干類，以部加兩位數字表示。	120
次類 (subclass)	類之下分為若干次類，以類加一個大寫英文字母表示。	628
主目 (group)	次類之下分為若干主目，以次類加1~3 位數字及「/00」表示。	69000
次目 (subgroup)	主目下分為若干次目，將主目之「/00」改為2~4 位數字表示。	

資料來源:本研究整理

二、按專利權人檢索

專利權人是調查專利的有用線索。但必須要知道專利權人的確切的名稱(人名、公司、廠家名)。掌握了專利權人的名稱，即可利用專利年度索引中的專利權人索引部分查出專利

號。

三、電腦檢索

電腦檢索則較無檢索範圍限制，可直接由電腦資料庫（或光碟資料庫）或藉由網路連上提供專利檢索的資料庫網址，再輸入檢索的條件，如關鍵字、發明人或專利權人、分類號、年限等資料，系統自動會在資料庫中動蒐索出相關資料，若要全文內容亦可透過圖書館或智慧財產局等申請，提出正確的專利號後，即可得到書面全文內容。目前在網際網路上，相關常用之專利資料庫搜尋網址如下表4-2。

表4-2 專利資料庫網址

站名	網址
Delphion patents server	http://www.delphion.com/
USPTO	http://www.uspto.gov/
中華民國經濟部智慧財產局	http://www.moeaipo.gov.tw/
Knight-Ridder Information Home Page	http://www.dialog.com/
APIPA	http://www.apipa.org.tw/
LEXIS-NEXIS Communication Center	http://www.lexis-nexis.com/

資料來源：本研究整理

知悉了上述幾個專利搜尋引擎後，於實際開始檢索時，主要必需掌握的將會是幾個重要相關欄位。一般而言，最常用之專利資料庫檢索的欄位為一專利號碼(Patent Number)、受讓人(Assignee)、發明人(Inventor)、發明名稱(Title)、摘要(Abstract)、申請日(Application date)、發證日(Issued date)、IPC(國際專利分類號)、UPC(美國專利分類號)及專利申請保護範圍(Claim)等。將所知之欄位，儘量鍵入(最常見是於title 及

abstract 之欄位下，輸入相關技術的key word 或於assignee 下指定欲查明之公司名稱)，再運用AND、OR 及NOT 等邏輯運算元，做Try and Error 之不斷修正測試，即可完成相關專利檢索工作以找出所需要的專利文獻。

目前完整的專利分析其流程如圖4-1所示：

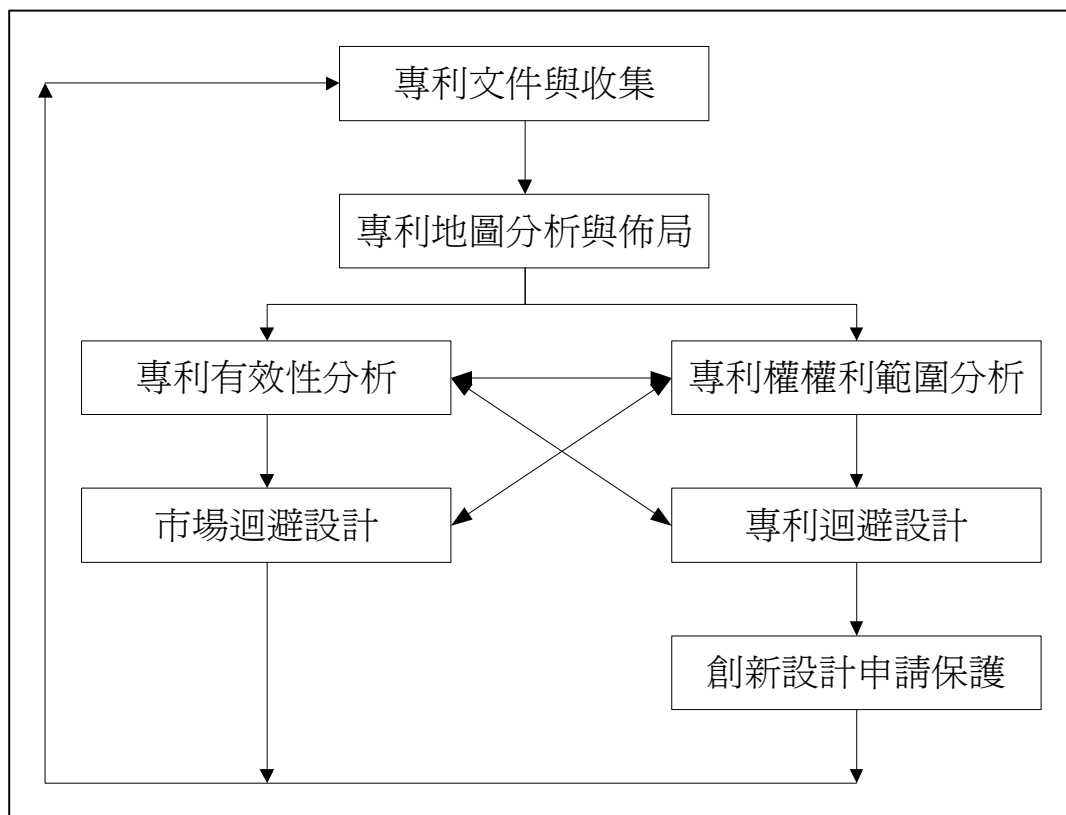


圖 4-1 專利分析流程

資料來源:本研究整理

第二節 專利說明書撰寫模式分析

在申請專利時專利說明書是用來加以闡述申請專利的重要文件而當中的請求專利部份為專利權人得主張專利之權利範圍，亦為歸納詳細說明所得的結論，應就發明或創作之範圍及特點具體明確的撰述。

我國專利法上對於專利範圍之解釋無明文規定，但審查專利申請案時，係以請求專利部份記載之技術內容為判斷之依據，至於其所運用之技術手段及是否有進步性(增進功效)、實用性或具有產業上之利用價值等，仍須參酌發明或創作之詳細說明與圖式。故請求專利部份記載之內容，亦必為詳細說明內所記載之技術內容。但是，不論詳細說明內如何詳細的記載，如未在請求專利部份內記載者，則一概不予承認。因此，撰述請求專利部份時，應作詳細的研究，如為發明或創作之內容中不可缺乏之構成部分，始予記載，但不能遺漏，如與發明或創作之技術內容無關之構成部分，則不予記載。如此，可使請求專利部份之範圍明確而具體。

一、通則

我國專利法及其施行細則，對於請求專利部份之記載方式，並無明文規定，國人申請專利時，所記述之請求專利部分更是五花八門。至目前為止，尚有作如下列之籠統記載者：

- 「如說明書中全部之技術創新者。」
- 「如圖所示之XXX裝置全部。」
- 「請求本發明創新之方法獲得保護。」
- 「本發明係依據槓桿原理研究設置之千斤頂。」

...

等等，這些請求專利部份的記載，都未將其發明或創作之技術內容全部揭露，自難作專利權之保護，經濟部中央標法局也不會據此准予專利。通常，如其說明書內尚有創新的技術內容時，中央標準局或許會通知申請人修正其請求專利部份，但是，往往經過再三的修正仍然無法做到妥切適當，而徒然浪費了許多的時間與人力物力。

撰寫請求專利部份之一般記載要領：

- (1) 記載請求專利部份，應明確敘述申請專利之標的，並將有關該發明或創作之技術內容中不可缺乏之構成部份，使用具體明確、清晰可辨之文詞記敘。於敘述構成元件時，應敘明其間相互之構成關係。
- (2) 敘述時，如有涉及物品或元件之大小、形狀、關係、方向或其他須依據人類之感覺始能判斷或量度之描述者，應同時敘明使熟悉該項技術者，能明確辨認之依據。
- (3) 記載請求專利部份時，如有涉及物品或方法之名稱，其名詞應前後一致。
- (4) 請求專利部份如有涉及元件名稱時，得以括弧之圖式標示符號輔助說明之。
- (5) 請求專利部份中使用「其」、「其中」、「如前述之」等文字形容時，其形容對象必須於請求專利部份中已確實描述及定義者。

二、請求專利記載模式

請求專利部份之記載方式，一般國人常用的單項式及多項式兩種。亦有參考外國專利案之記載方式者，例如吉普森式(Jepson Type Claims)、馬庫西式(Markush Claims)等方式。因為各個發明或創作之技術內容互異，很難說何種記載方式最恰當，而且每一種記載方式都有其表達的特點。茲就各種記載方式分別舉例說明如下：

(一) 單項式請求專利部份

「單項式」之請求專利部份係以單項文字記載，其一般形式分為前言部份、連接部

份、請求專利之技術主體部份等三部份。

「前言部份」係指請專利之主題標的，通常是記載發明(或創作)之方法或物品之名稱。

「連接部份」係將前言部份與技術主體部份連貫為一完整的敘述，通常使用者如「包含：」、「包括：」、「其特徵為(在)：」、「係由……組成」等。

「請求專利之技術主體部份」，若發明為方法者，應敘述其有關之動作過程、操作手段或步驟、條件、原料及其特徵以及其結合關係等。若發明或創作為物品者，應敘述其有關之組合元件及其形狀、構造或裝置之特徵以及其結合關係等。必要時，在敘述上述各必要之記載後，得扼要述及其必然之功效。

例如：一種索引裝置，包括 A、B、C 三個元件，其中：A 與 B 之技術關係為 ⊙，B 與 C 之技術關係為 ☆，A 與 C 之技術關係為 △。(⊙，☆，△ 為技術關係代表符號。)

說明：上例中之「前言部份」為一種索引裝置，「連接部份」為包括，「技術主體部份」為元件 A、B、C 及 AB、BC、AC 之技術關係。

其涵蓋之範圍為如圖 4-2 所示：

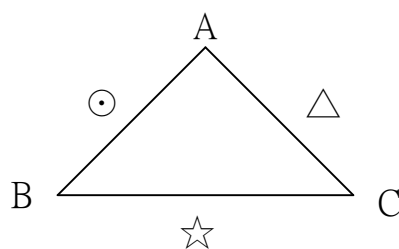


圖 4-2 A、B、C 之技術關係

(二) 多項式請求專利部份

多項式請求專利部份之記載，應將請求專利之主題標的，依一、二、三、……(或 1、2、3、……)之次序分項敘述，並分為獨立請求部分(獨立項)與附屬請求部分(附屬項)。

- (1) 獨立請求部份(獨立項)為該發明或創作中，得單獨請求專利之部份，應載明該部份之全部必要技術內容。
- (2) 附屬請求部份(附屬項)附屬於獨立請求部份者為直接附屬項，附屬於附屬請求部份(附屬項)者為間接附屬項。

多項式請求專利部份應注意發明之單一性，依據專利法第 21 條之規定，原則上一發明一申請，亦即規定其請求專利部份只能有一個獨立項。但是，如二個以上發明在利用上不可分離時，可併於一申請案中(如物品之製造方法及其裝置)，則其請求專利部份可以有二個以上之獨立項。新型專利，因專利法第 110 條無準用第 21 條之規定，故必須一個創作一申請案，亦即其請求專利部份僅能有一個獨立項。

依照慣例，一個獨立項請求專利部份並附屬一系列之附屬項，被視為一發明或一創作。其詳細規定如下：

- (1) 附屬請求部分可為該獨立請求部分之同一範圍內作進一步之「細部描述」(限制)(即對獨立項中某一元件加以更明確的敘述，而不加入獨立項中沒有的新元件)，其敘述方式為「如請求專利部份第 X 項(指依附之獨立項，通常為第一項)之◎◎(指該獨立項之主題標的)，其中之△△(指對獨立項中，欲作細部描述之部分)，係：……………」或者「依據請求專利部份第 X 項之◎◎，其中之△△係……………」

例如：請求專利部份為：

1. 一種索引裝置，包括 A、B、C 三個元件，其中：

A 與 B 之間的技术關係為◎；（◎、☆、△為技術關係代表符號）

B 與 C 之間的技术關係為☆；

A 與 C 之間的技术關係為△。

2. 如請求專利部份第一項之一種索引裝置，其中之 A 係 $a_1 \times a_2$ 構成（ \times 為 a_1 與 a_2 之間的技术關係）。

說明：

第 1 項為獨立請求部份(獨立項)，其涵蓋之範圍如圖 4-3 所示：

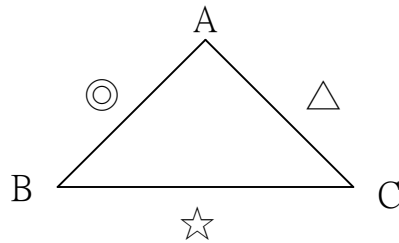


圖 4-3 A、B、C 之技術關係

第 2 項為附屬請求部份(直接附屬項)，其涵蓋範圍如圖 4-4 所示：

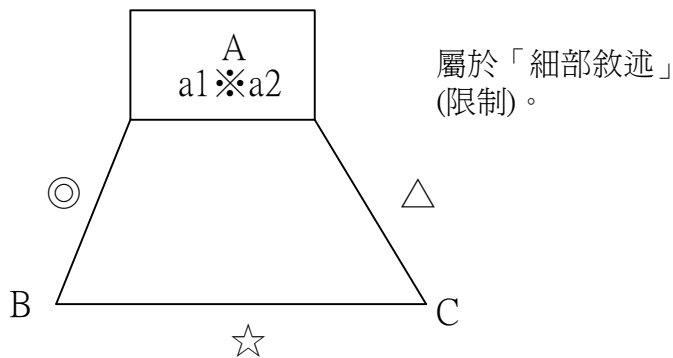


圖 4-4 $A(a_1 \times a_2)$ 、B、C 之技術關係

(2) 附屬請求部份亦可為該獨立請求部份之同一範圍內某項之「附加描述」(延伸)(係於獨立項之外，增加新內容者)，其敘述方式為：「如(或依據)請求專利部份第 X 項之◎◎，其中之△△係……………」。

例如：請求專利部份為：

1. 一種索引裝置，包括 A、B、C 三個元件，其中：
A 與 B 之間的技术關係為◎；
B 與 C 之間的技术關係為☆；
A 與 C 之間的技术關係為△。
2. 如請求專利部份第 1 項之一種索引裝置，其中之 A 係 a₁※a₂之間的技术關係為※。
3. 如請求專利部份第 1 項之一種索引裝置，其中之 B 附加 D，而 B 與 D 之技術關係為#。
4. 如請求專利部份第 2 項或第 3 項之一種索引裝置，其中之 C 附加 c₁和 c₂，而 C 與 c₁之技術關係為 X，C 與 c₂之技術關係為 Y，c₁與 c₂之技術關係為 Z，c₁與 B 之技術關係為 Σ。

說明：

1. 第 1 項(獨立項)涵蓋之範圍如圖 4-5 所示：

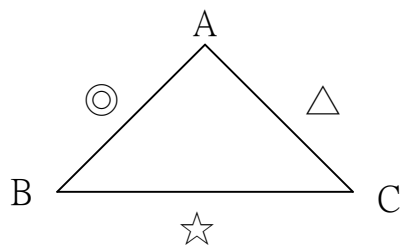


圖 4-5 A、B、C 之技術關係

第 2 項(附屬項)涵蓋之範圍如圖 4-6 所示為：

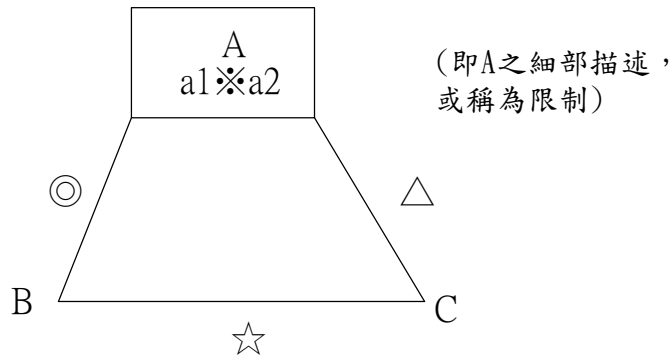


圖 4-6 A(a₁※a₂)、B、C 之技術關係

第 3 項(附屬項)涵蓋之範圍如圖 4-7 所示為：

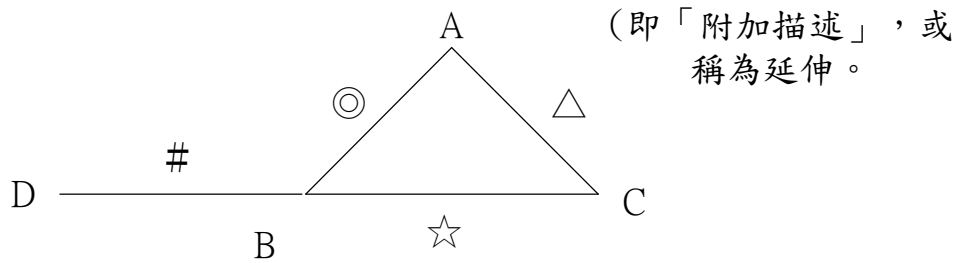


圖 4-7 A、B、C、D 之技術關係

第 4 項(多項附屬項，亦為間接附屬項)涵蓋之範圍如圖 4-8 所示為：

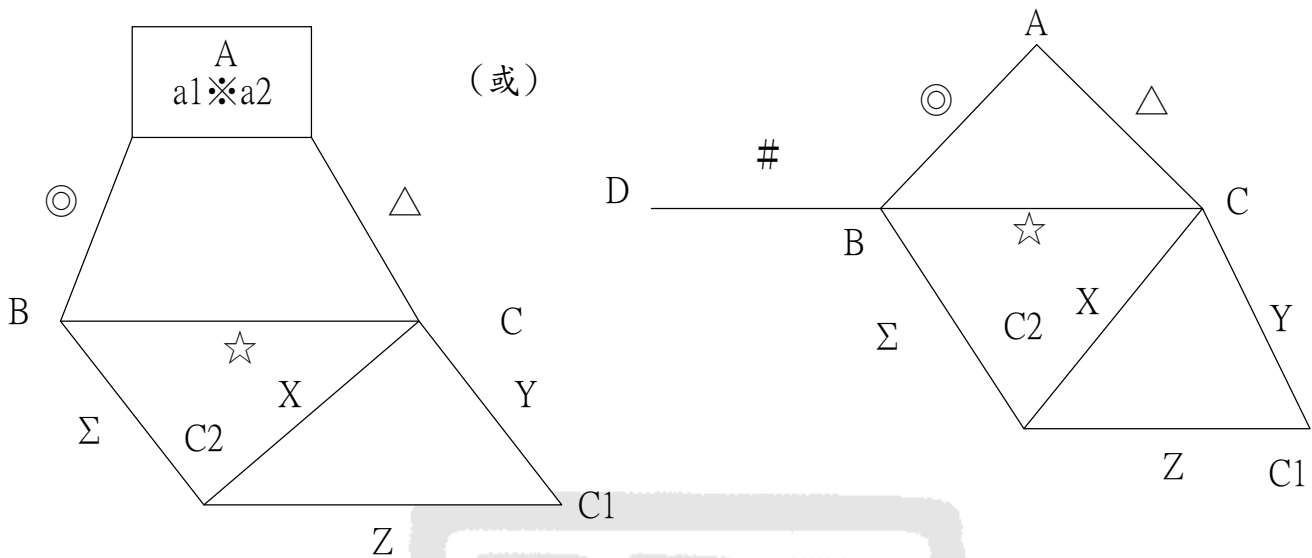


圖 4-8 A、B、C、C1、C2 之技術關係

2. 由本例可知附屬請求部份可為獨立請求部份之細部(限制)描述(如第 2 項)，亦可為獨立請求部份之附加(延伸)描述(如第 3 項)，或可為細部描述與附加描述同時敘述(如第 4 項)。
3. 多項式請求專利部份之專利範圍，必因為限制條件之增多而更形狹窄。例如，本例中第 1 項(獨立項)之專利範圍最廣，第 2 項、第 3 項次之，第 4 項之範圍最狹窄。
4. 本例中第 4 項，為間接附屬於獨立項之間接附屬項。

(3) 吉普森式(Jepson Type Claims)請求專利部份

記載請求專利部份時，倘涉及已知構件或先存技術，而有載明之必要者，得於敘述特徵部份之前予以引述。該項引述部份，係為該發明或創作技術內容應用上之基礎

或其限制條件，不得將其與特徵部份分離而單獨主張專利權。此種所謂吉普森式之敘述方式，於單項式或多項式中之獨立項均可適用。「再發明」之專利申請案，其請求專利部份之記載，採用吉普森式較為適當，因其再發明(改良部份)必須利用(涉及)原發明之技術(先存技術)。

吉普森式之記載形式為：「一種 XX(主題標的)，包括(或包括…或由……組成等)……(……指已知構件或先存技術)，其特徵(或特點、改良部份等)在(或在於、為、包含、包括等)◎◎◎(創新或改良之部份)。」

例 1：(單項式)

一種索引裝置，包括 A、B、C 三個元件，其中：

A 與 B 之間的技術關係為◎，

B 與 C 之間的技術關係為☆，其特徵在：A 與 C 之間的技術關係為△。

說明：

1. 本例之涵蓋範圍如圖 4-9 所示為：

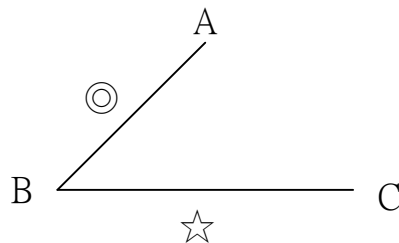


圖 4-9 AB、BC 之技術關係

2. 例 1 之改良部份為 A 與 C 之間的技術關係(A[△]-C)部份，故其特徵部份之前的敘述應為先存技術，如圖 4-10 所示：

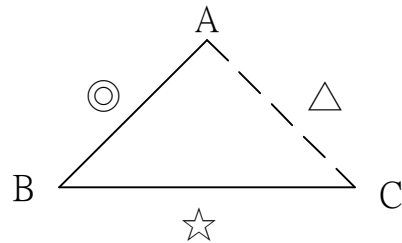


圖 4-10 A、B、C 之技術關係

3. 應注意的是：其改良部份 A[△]---C 之技術，不能單獨主張專利權，必須以先存技術為基礎，方能主張其專利權。如圖 4-11 所示。

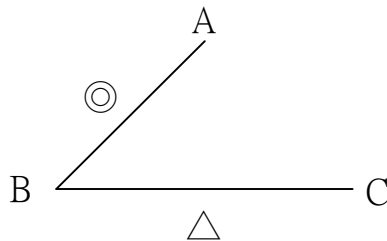


圖 4-11 A、B、C 之技術關係

例 2：(多項式)

1. 一種索引裝置，包括 A、B、C 三個元件，其中：
 - A 與 B 之間的技術關係為 ⊙，
 - B 與 C 之間的技術關係為 ☆，其特徵在：A 與 C 之間的技術關係為 △。
2. 如請求專利部份第 1 項之索引裝置，其特徵在：B 附加 D 元件，而 B 與 D 之間的技術關係為 #。

3. 如請求專利部份第 2 項之索引裝置，其中 D 與 C 之間的技术關係為*。

說明：

1. 第 1 項之說明同例 1。
2. 第 2 項之涵蓋範圍，如圖 4-12 所示為：

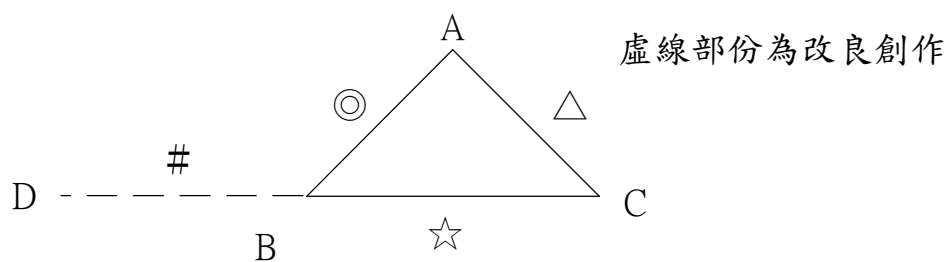


圖 4-12 A、B、C、D 之技術關係

3. 第 3 項之涵蓋範圍如圖 4-13 所示為：

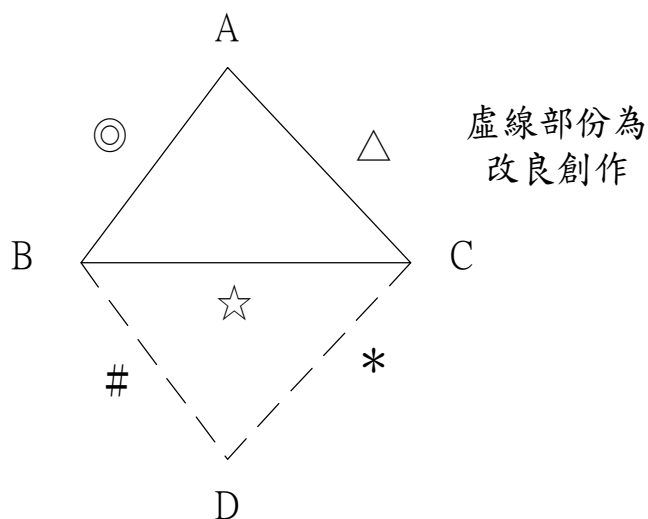


圖 4-13 A、B、C、D 之技術關係

(4) 馬庫西式(Markush Claims)請求專利部份

馬庫西式請求專利部份的記載，通常適用於有關化學類的發明案件，一般係在材料的選擇時，使用此種方式寫出。其敘述方式為：「……其中……所組成之群類中選出……」，或「……其中 XX 至少一種選自……」。此種記載方式，材料選擇(如……選出，或一種選自……)愈多，則其專利涵蓋範圍愈廣。此為與其他請求專利部份記載方式不同之處(其他記載方式，如所列元件愈多，則其專利範圍愈狹窄)。

第五章 研究結果

本章針對所選擇的九篇新型專利說明書來加以分析其屬於何種模式。

第一節 請求專利部份模式分析

針對所搜尋出的九篇新型專利說明書，每一篇均去加以分析其申請專利範圍如此才能加以分析其專利技術關係如此才能判斷其屬於何種模式。

九篇新型專利說明書分列如下：

1. 電子構件送料軌道結構改良
2. 具有一吸管之液體容器
3. 迷你光碟片包裝盒
4. 蒸餾水之握把
5. 緊急按鈕保護蓋
6. 光感測半導體元件之構裝結構改良
7. 分岐器之結構改良
8. 可快速組裝之插座
9. 通訊接頭之防潮裝置

一、電子構件送料軌道結構改良

本篇專利類別編號 B654G17/46，申請日期 91.03.04，申請事務所台一國際商標事務所，代理人林鎰珠先生。其主要申請專利範圍內容如下：

1. 一種電子構件送料軌道結構改良，其係一導軌，該導軌相對於供該載裝帶移動之一面，至少於兩端各設有一主容置槽及一副容置槽，且該主容置槽及副容置槽各分別沿該導軌長面呈水平狀設置，而該主容置槽及副容置槽內各設有兩磁鐵，兩磁鐵之長度係對應該主容置槽及副容置槽之長面設置，且兩磁鐵頂面係呈相互不同極

性，而使兩磁鐵相鄰靠之面為極性相反，能相互吸附，且分別固設於該主容置槽及副容置槽內者。

2. 如申請專利範圍第 1 項所述之電子構件送料軌道結構改良，其中該主容置槽一端係貫穿於該導軌之一外端面，且該導軌於該副容置槽兩端設呈封閉面者。
3. 如申請專利範圍第 1 或 2 項所述之電子構件送料軌道結構改良，其中該導軌設為鐵質，以供各磁鐵能分別吸附固定於該主、副容置槽內者。

由上述專利範圍來判斷其結構分析如下：

(1)、申請專利範圍第一項內容屬於為該發明或創作中，得單獨請求專利之部份，應載明該部份之全部必要技術內容，故屬於獨立請求部份(獨立項)。

(2)、申請專利範圍第二項內容可為該獨立請求部分之同一範圍內作進一步之「細部描述」(限制)(即對獨立項中某一元件加以更明確的敘述，而不加入獨立項中沒有的新元件)，故屬於附屬請求部分。

其詳細關係如圖 4-4 所示，其中 A(a1*a2)為申請專利範圍中第二項所說明事項也可稱為附屬請求部分。

經由上述分析得知，結構屬於多項式。

二、具有一吸管之液體容器

本篇專利類別編號 B65D81/20，申請日期 90.05.4，申請事務所理律法律事務所，代理人陳長文先生。其主要申請專利範圍內容如下：

1. 一種液體容器，包含：

一蓋；

一容器主體，具有一開口、一內底部、一第一密封裝置以封閉容器主體之一截面，

開口係由蓋圍封，以形成一容室於蓋與第一密封裝置之間；

一吸管，具有一周側壁、一開口端及一封閉端，開口端接觸第一密封裝置，封閉

端則接附於容器主體之內底部，一第一孔進一步設於封閉端上方之吸管之周側壁上；及

一中空接頭，係設於容室內，接頭具有一端供刺穿第一密封裝置，以結合及連接於吸管之開口端，藉此，容器主體內之液體可自第一孔流過吸管而流出接頭。

2. 如申請專利範圍第 1 項之液體容器，其中第一密封裝置覆蓋容器主體之開口。
3. 如申請專利範圍第 1 項之液體容器，進一步包含一第二密封裝置，係覆蓋容器主體之開口。
4. 如申請專利範圍第 3 項之液體容器，其中第一密封裝置及第二密封裝置各由層狀材料製成。
5. 如申請專利範圍第 1 項之液體容器，其中接頭係一中空主管，及進一步包含一中空通氣管，其具有一端且利用一水平連桿以平行地與主管銜接，藉此，當主管之末端刺穿第一密封裝置時，通氣管之末端亦刺穿第一密封裝置，使得空氣可自通氣管流入容器主體。
6. 如申請專利範圍第 5 項之液體容器，其中吸管進一步包含一第二孔於其周側壁上，且接近於開口端及相對立於通氣管，及主管進一步具有一周側壁，其上設有一孔且在連桿下方，藉此當主管與吸管之開口端結合且吸管之第二孔對準於主管之孔時，藉由臥置容器主體則容器之液體將輕易流出容器。
7. 如申請專利範圍第 1 項之液體容器，其中容器主體之內底部具有一凸形中央部，而內底部之其餘部分呈平坦狀，且吸管之封閉端接附於內底部之平坦部。
8. 一種液體容器，包含：
 - 一蓋；
 - 一容器主體，具有一開口、一內壁、一第一密封裝置以封閉容器主體之一截面，開口係由蓋圍封，以形成一容室於蓋與第一密封裝置之間；
 - 一第一短吸管，具有一周側壁、一開口端及一封閉端，周側壁接附於容器主體之

內壁且設有一孔於其上，開口端接觸第一密封裝置；

一主接頭，係設於容室內，主接頭具有一周側壁及一端供刺穿第一密封裝置，以結合及連接於第一吸管之開口端，一孔設於主接頭之周側壁上，藉此當主接頭結合於第一短吸管之開口端時，液體之流動速率可藉由對準第一短吸管上之孔及主接頭之孔，及藉由臥置容器主體，容器主體內之液體即可自第一短吸管之孔流出主接頭。

9. 如申請專利範圍第 8 項之液體容器，其中第一密封裝置覆蓋容器主體之開口。
10. 如申請專利範圍第 8 項之液體容器，進一步包含一第二密封裝置，係覆蓋容器主體之開口。
11. 如申請專利範圍第 10 項之液體容器，其中第一密封裝置及第二密封裝置各由層狀材料製成。
12. 如申請專利範圍第 8 項之液體容器，進一步包含：
 - 一第二短吸管，具有一周側壁、一第一開口端及一第二開口端，周側壁接附於容器主體之內壁，且大致相對立於第一短吸管，第二短吸管之第一開口端接觸第一密封裝置；及
 - 一通氣接頭，係設於容室內，通氣接頭具有一端供刺穿第一密封裝置，以結合及連接於第二短吸管之第一開口端，藉此空氣可流過通氣接頭及第二短吸管，以流入容器主體。
13. 如申請專利範圍第 9 項之液體容器，其中第二短吸管係呈 L 形

由上述專利範圍來判斷其結構分析如下：

- (1)、申請專利範圍第一項內容屬於為該發明或創作中，得單獨請求專利之部份，應載明該部份之全部必要技術內容，故屬於獨立請求部份(獨立項)。
- (2)、申請專利範圍自第二項起至第十三項內容可為該獨立請求部分之同一範圍內作進

一步之「細部描述」(限制)(即對獨立項中某一元件加以更明確的敘述，而不加入獨立項中沒有的新元件)，故屬於附屬請求部分。

其詳細關係如圖 4-4 所示，其中 A(a1*a2)為申請專利範圍中第二項起至第十三項所說明事項也可稱為附屬請求部分。

經由上述分析得知，結構屬於多項式。

三、迷你光碟片包裝盒

本篇專利類別編號 B650D85/57，申請日期 91.03.04，申請事務所台一國際商標事務所，代理人林鎰珠先生。其主要申請專利範圍內容如下：

1. 一種迷你光碟片包裝盒，包括：一下蓋，該下蓋兩側分別形成有一凹槽；其特徵在於：

於下蓋中央朝上凸伸形成兩相對的按壓部，各按壓部內側分別形成有相對的弧形部，各按壓部外側分別形成一通孔；

各按壓部分別朝外側凸伸形成一勾部，且該通孔係位於扣持部之外。

2. 如申請專利範圍第 1 項所述之迷你光碟片包裝盒，其中各通孔 係呈 U 形。

由上述專利範圍來判斷其結構分析如下：

(1)、申請專利範圍第一項內容屬於以單項文字記載，其一般形式分為前言部份、連接部份、請求專利之技術主體部份等三部份。。

(2)、記載請求專利部份時，對於已知構件或先存技術，於敘述特徵部份之前予以引述。該項引述部份，係為該發明或創作技術內容應用上之基礎或其限制條件，無將其與特徵部份分離而單獨主張專利權。

(3)、前言部份為「一種迷你光碟片包裝盒」，連接部份為「包括：一下蓋，該下蓋兩側分別形成有一凹槽」，請求專利之技術主體部份「特徵在於：..... 且該通孔係位於扣持

部之外。」

(4)、申請專利範圍第二項內容屬於附屬請求部份。

其詳細關係如圖 4-12 所示。上述分析得知，結構屬於吉普森式之多項式。

四、蒸餾水之握把

本篇專利類別編號 B65D23/10，申請日期 90.06.08，申請事務所聖島國際專利商標聯合事務所，代理人陳文郎先生。其主要申請專利範圍內容如下：

1. 一種蒸餾水桶之握把，該蒸餾水桶具有一底壁、一自底壁周緣向上延伸的周壁、一由周壁之一頂緣縮束而成的桶口，及一形成於該周壁之一側具有一向外開口的凹陷部，該凹陷部具有一位於該周壁之一內側的直立壁，及一分別自該直立壁之一上、下側緣對應向外延伸連接該周壁的上、下壁；該握把是固定裝設在該蒸餾水桶之凹陷部，包含：
 - 一撐桿，它的長度較長於該凹陷部之上、下壁間的距離，並具有一被包夾固定於該凹陷部之直立壁中的撐立部之二相反端朝該直立壁之上下側緣內凸伸的定位部，及二形成於該撐立部鄰接於該直立壁之二相對側面的嵌槽，該等定位部是分別具有一對應朝該凹陷部開口的方向彎折的彎鉤，以在與該二撐桿銜接之處界定出一可容該上、下壁填入包嵌的鉤槽，以阻止該握把朝開口外脫離；
 - 一握桿，是與該撐桿相對間隔地裝設在該凹陷部之開口處，具有二分別鄰抵於該上、下壁的相反端，該等相反端分別具有一可容該上、下壁凸伸進入的開槽；
 - 及二連桿，是分別上下連接於該撐桿及握桿之間，該等連桿分別具有一朝該上、下壁內凸伸的凸固部，該等凸固部是分別具有一對應朝該凹陷部開口的方向彎折的彎鉤，以界定出一可容該上、下壁填入包嵌的卡槽，且該二凸固部之距離大於該上、下壁的間距，能阻止該握把朝開口外脫。

由上述專利範圍來判斷其結構分析如下：

(1)、申請專利範圍第一項內容屬於以單項文字記載，其一般形式分為前言部份、連接部份、請求專利之技術主體部份等三部份。

(2)、此發明為一物品，敘述其有關之組合元件及其形狀、構造或裝置之特徵以及其結合關係等。在範圍中敘述上述各必要之記載後，並扼要述及其必然之功效。

其詳細關係如圖 4-2 所示。上述分析得知，結構屬於單項式。

五、緊急按鈕保護蓋

本篇專利類別編號 B65D23/10，申請日期 90.06.08，申請事務所聖島國際專利商標聯合事務所，代理人陳文郎先生。其主要申請專利範圍內容如下：

1. 一種緊急按鈕保護蓋，用以設置於一內含緊急按鈕之緊急裝置之開口外周緣，其包括：

一按壓板片；

一外框，其環繞在該按壓板片外圍並與按壓板片間相互間隔；

一連接裝置，用以使該按壓板片與該外框之間相互連接；其中

該連接裝置在一操作者之適當按壓力施壓於該按壓板片後會斷裂，致使該按壓板片被驅動脫離該外框，並施壓於該緊急按鈕上。

2. 如申請專利範圍第 1 項之緊急按鈕保護蓋，其中連接裝置為點狀連接結構。

由上述專利範圍來判斷其結構分析如下：

(1)、申請專利範圍第一項內容為該發明或創作中，得單獨請求專利之部份，同時載明該部份之全部必要技術內容，是為獨立請求部份(獨立項)。

(2)、申請專利範圍第二項內容為附屬於獨立請求部份者為直接附屬項，是為附屬請求部份(附屬項)。

其詳細關係如圖 4-2 所示。上述分析得知，結構屬於多項式。

六、光感測半導體元件之構裝結構改良

本篇專利類別編號 H01L23/053，申請日期 90.10.09，申請事務所台一國際商標事務所，代理人林鎰珠先生。其主要申請專利範圍內容如下：

一種光感測半導體元件之構裝結構改良，其包括：

一載體，其上具有複數自頂面延伸至底面的端子；

一膠體堤牆，係固設於載體頂面外圍處，其頂部內緣形成一定位環槽及至少一自定位環槽通過側壁延伸至外側的排氣槽；

一晶片，係黏固於載體上相對於膠體堤牆內側，晶片上具有一光感測區以及複數位周邊的數 I/O 接點，各 I/O 接點自以金屬線與載體上對應的端子構成電性連接；以及

一透明蓋板，係對應黏固於膠體堤牆上的定位環槽中，將晶片密封於內，且晶片上光感測區正對透明蓋板，而構成一光感測半導體元件。

2. 如申請專利範圍第 1 項所述之光感測半導體元件之構裝結構改良，其中膠體堤牆上具有四個自定位環槽通過側壁延伸至外側的排氣槽，該四排氣槽並分佈於方形定位環槽之各端角處。

3. 如申請專利範圍第 1 項或 2 項所述之光感測半導體元件之構裝結構改良，其中載體為軟板式基板。

4. 如申請專利範圍第 1 項或 2 項所述之光感測半導體元件之構裝結構改良，其中載體為硬式基板。

5. 如申請專利範圍第 1 項或 2 項所述之光感測半導體元件之構裝結構改良，其中載體為具有晶片座、複數導電引腳的金屬導線架，該導線架相對於晶片座與導電引腳間之間隙以及相鄰引腳間之間隙充填有隔離膠體，而構成一平板狀載體。

由上述專利範圍來判斷其結構分析如下：

(1)、申請專利範圍第一項內容為該發明或創作中，得單獨請求專利之部份，同時載明該部份之全部必要技術內容，是為獨立請求部份(獨立項)。

(2)、申請專利範圍第二項至第五項內容為附屬於獨立請求部份者為直接附屬項，是為附屬請求部份(附屬項)。

其詳細關係如圖 4-2 所示。上述分析得知，結構屬於多項式。

7. 分歧器之結構改良

本篇專利類別編號 H02G15/113，申請日期 90.04.12，申請事務所理律法律事務所，代理人陳長文先生。其主要申請專利範圍內容如下：

1. 一種分歧器，包含

一上蓋，其一側設有一包含複數個第一開口之梯形槽；

一上墊圈，其一側設有一包含對應於該等第一開口之複數個第二開口之梯形部份，該梯形部份適於置入該上蓋之該梯形槽中；

一下蓋，其一側設有一包含複數個第三開口之梯形槽；及

一下墊條，呈梯形並設有對應於該等第三開口之複數個第四開口，該下墊條適於置入該下蓋之該梯形槽中。

2. 如申請專利範圍第 1 項之分歧器，其中該分歧器為一雙絞線分歧器。

3. 如申請專利範圍第 1 項之分歧器，其中該分歧器為一包含視訊信號及電話信號之分歧器。

4. 如申請專利範圍第 1 項之分歧器，其中該上蓋在該梯形槽外更包含一環形槽。

5. 如申請專利範圍第 1 項之分歧器，其中該上蓋之該梯形槽之正面及側面皆呈梯

形。

6. 如申請專利範圍第 1 項之分歧器，其中該上墊圈之該梯形部份之正面及側面皆呈梯形。
7. 如申請專利範圍第 1 項之分歧器，其中該下墊條之二側更各包含一柱形體。如申請專利範圍第 7 項之分歧器，其中該柱形體為圓形柱或方型柱。
8. 如申請專利範圍第 1 項之分歧器，其中該下蓋之該梯形槽之二側更各包含一孔洞。
9. 如申請專利範圍第 1 項之分歧器，其中該上蓋或下蓋之該梯形槽之內側外側間有一高度差。
10. 如申請專利範圍第 1 項之分歧器，其中該等開口用以收納電話線。
11. 如申請專利範圍第 1 項之分歧器，其中該下蓋之該梯形槽之正面及側面皆呈梯形。
12. 申請專利範圍第 1 項之分歧器，其中該下墊條之正面及側面皆呈梯形。

由上述專利範圍來判斷其結構分析如下：

(1)、申請專利範圍第一項內容為該發明或創作中，得單獨請求專利之部份，同時載明該部份之全部必要技術內容，是為獨立請求部份(獨立項)。

(2)、申請專利範圍第二項至第十二項內容為附屬於獨立請求部份者為直接附屬項，是為附屬請求部份(附屬項)。

其詳細關係如圖 4-2 所示。上述分析得知，結構屬於多項式。

八、可快速組裝之插座

本篇專利類別編號 H02G15/113，申請日期 90.04.13，申請事務所聖島國際專利商標聯合事務所，代理人陳文郎先生。其主要申請專利範圍內容如下：

1、一種可快速組裝之插座，該插座至少可供一插頭插設，此插座包含：

一可對接組裝之殼座，具有相對立之一頂板與一底板，且殼座具有彼此遠離的一連結端與一控制端；

一控制裝置，裝設於該殼座之控制端上，其具有間隔設置的一第一銷桿、一第二銷桿及一第三銷桿；

至少兩用以與該插頭電氣連結的導板，均直立組裝於該殼座之頂板上，每一導板具有與該等銷桿連接的一第一端與遠離該第一端的一第二端，而該等導板之第一端分別是與該第一、二銷桿連接；

至少兩導線，均具有內外對應設置的一導電部與一絕緣部，其中一導線是與該第三銷桿連接，而另一導線是與該等導板其中之一之第二端連接；

數量配合該等導線的套設夾，該套設夾具有一固接於該導線之絕緣部的環壓部，一與導線之導電部抵接的傳導部，以及一套持部，且該套特部形成一套持空間可反覆拆卸地套接於該導板之第二端。

2、根據申請專利範圍第1項所述可快速組裝之插座，其中，該套持部具有有一略呈矩形基板，以及兩由基板平行導線長度方向的兩側相向彎折延伸的彎扣片。

3、根據申請專利範圍第2項所述可快速組裝之插座，其中，該等套持部之基板上均設有一貫穿板體的定位槽，而該等導板之第一端處亦形成一配合該定位槽的定位凸肋。

4、根據申請專利範圍第1項所述可快速組裝之插座，更包含另一導線與另一導板，該導線是配合該導板作為接地導電之用。根據申請專利範圍第1項所述可快速組裝之插座，更包含二用以電氣連結該導板與該控制機構的卡接板，每一卡接板板體藉沖壓形成兩容插部，分別供該導板之第二端以及該控制裝置之一銷桿插設。

5、根據申請專利範圍第1項所述可快速組裝之插座，其中，該殼座更具有若干可供

該導線纏繞定位的凸柱。

6、根據申請專利範圍第1項所述可快速組裝之插座，其中，該殼座之頂板上凸設二用以供該等套設夾卡嵌定位的撐架

由上述專利範圍來判斷其結構分析如下：

(1)、申請專利範圍第一項內容為該發明或創作中，得單獨請求專利之部份，同時載明該部份之全部必要技術內容，是為獨立請求部份(獨立項)。

(2)、申請專利範圍第二項至第六項內容為附屬於獨立請求部份者為直接附屬項，是為附屬請求部份(附屬項)。

其詳細關係如圖 4-2 所示。上述分析得知，結構屬於多項式。

九、通訊接頭之防潮裝置

本篇專利類別編號 H001R13/52，申請日期 90.09.25，申請事務所聖島國際專利商標聯合事務所，代理人陳文郎先生。其主要申請專利範圍內容如下：

1、一種通訊接頭之防潮裝置，該接頭中容置有一絕緣殼體以及一固定於該絕緣殼體中之接觸端子，且該絕緣殼體朝外的一端具有一開口供一纜線置入以插接於該接觸端子上；該防潮裝置包括：

一防水塞件，其置入上述接頭中以堵塞於上述絕緣殼體之開口上，該防水塞件中央具有一與該絕緣殼體開口對應以供該纜線插穿之彈性密閉穿孔，其鄰近該絕緣殼開口的一端形成有一凸環緣；及

一迫緊件，其由上述防水塞件的另一端緊配合地置入該防水塞件與該接頭之內壁面之間並抵壓該防水塞件之凸環緣，以將該防水塞件迫緊固定於該接頭內。

2、依申請專利範圍第1項所述通訊接頭之防潮裝置，該防水塞件之凸環緣底面朝該絕緣殼體之開口方向更垂直延伸有一內塞體，該內塞體可對應擋塞於該絕緣殼體之開口內共包圍於該接觸端子的外周圍。

- 3、依申請專利範圍第 1 項所述通訊接頭之防潮裝置，其中該防水塞件是一可供該纜線插穿的彈性體。
- 4、依申請專利範圍第 3 項所述通訊接頭之防潮裝置，當該纜線未插接於該接頭上時，該防水塞件之彈性密閉穿孔是處於密閉狀態，而當該纜線插入該彈性密閉穿孔時，該纜線可刺穿該穿孔並穿經該絕緣殼體之開口而插接於該接觸端子上，且當該纜線被拔出該彈性密閉穿孔時，該彈性密閉穿孔即又回覆至密閉狀態。
- 5、依申請專利範圍第 1 項所述之通訊接頭之防潮裝置，其中該迫緊件是一銅製套環，其由上述防水塞件的另一端套入該防水塞件與該接頭之內壁面之間並抵壓該防水塞件之凸環緣，而將該防水塞件迫緊固定於該接頭內。

由上述專利範圍來判斷其結構分析如下：

- (1)、申請專利範圍第一項內容為該發明或創作中，得單獨請求專利之部份，同時載明該部份之全部必要技術內容，是為獨立請求部份(獨立項)。
- (2)、申請專利範圍第二項至第五項內容為附屬於獨立請求部份者為直接附屬項，是為附屬請求部份(附屬項)。

其詳細關係如圖 4-2 所示。上述分析得知，結構屬於多項式。

第二節 分析結果

一、請求專利部份模式驗證結果

經由上述分析與檢驗我們可以得知目前國內專利申請事務所仍然是依照早期所製定的撰寫模式來加以撰寫，其語法結構並無太大之變化和早期的模式大致相同。其詳細資料如表 5-1 所列。

二、撰寫模式潮流

根據表 5-1 所列資料我們可以歸納出表 5-2，從表 5-2 當中可以得知目前國內專利事務所是以多項式模式來作為申請「請求專利部份」的主要寫法，其次為單項式模式與吉普森式模式。也由此可大約得知馬庫西式模式只限用於化學類方面專利申請。

三、申請專利範圍限制

從上九篇專利說明書當中可發現使用多項式模式申請的 7 篇專利當中，其有一特徵為所能申請專利保護範圍較小，因為其附屬項多則其申請專利保護範圍越小。在使用單項式模式申請的專利當中，可發現到其申請專利保護範圍較大，因為其無附屬項。

而使用吉普森式模式申請之專利當中可明確看出其要申請專利的要項，其申請保護範圍則並不一定，必須看所申請的要項來決定。

所以在申請專利時應先妥善思考所要申請專利保護範圍，在來決定要使用何種模式來加以撰寫申請專利。

表 5-1 專利分析結果總表

項次	專利名稱 編號	申請日期	撰寫模式	事務所
1	電子構件送料軌道結構改良 B65G17/48	91.03.04	多項式	台一國際商標事務所
2	具有一吸管之液體容器 B65D77/28	90.05.04	多項式	理律法律事務所
3	迷你光碟片包裝盒 B65D85/57	91.03.04	吉普森式	台一國際商標事務所
4	蒸餾水之握把 B65D23/10	90.06.08	單項式	聖島國際專利商標聯合 事務所
5	緊急按鈕保護蓋 H01H13/00	90.05.08	多項式	理律法律事務所
6	光感測半導體元件之構裝結 構改良 H01L23/053	90.10.19	多項式	台一國際商標事務所
7	分歧器之結構改良 H02G15/113	90.04.12	多項式	理律法律事務所
8	可快速組裝之插座 H01R13/428	90.04.13	多項式	聖島國際專利商標聯合 事務所
9	通訊接頭之防潮裝置 H01R13/52	90.09.25	多項式	聖島國際專利商標聯合 事務所

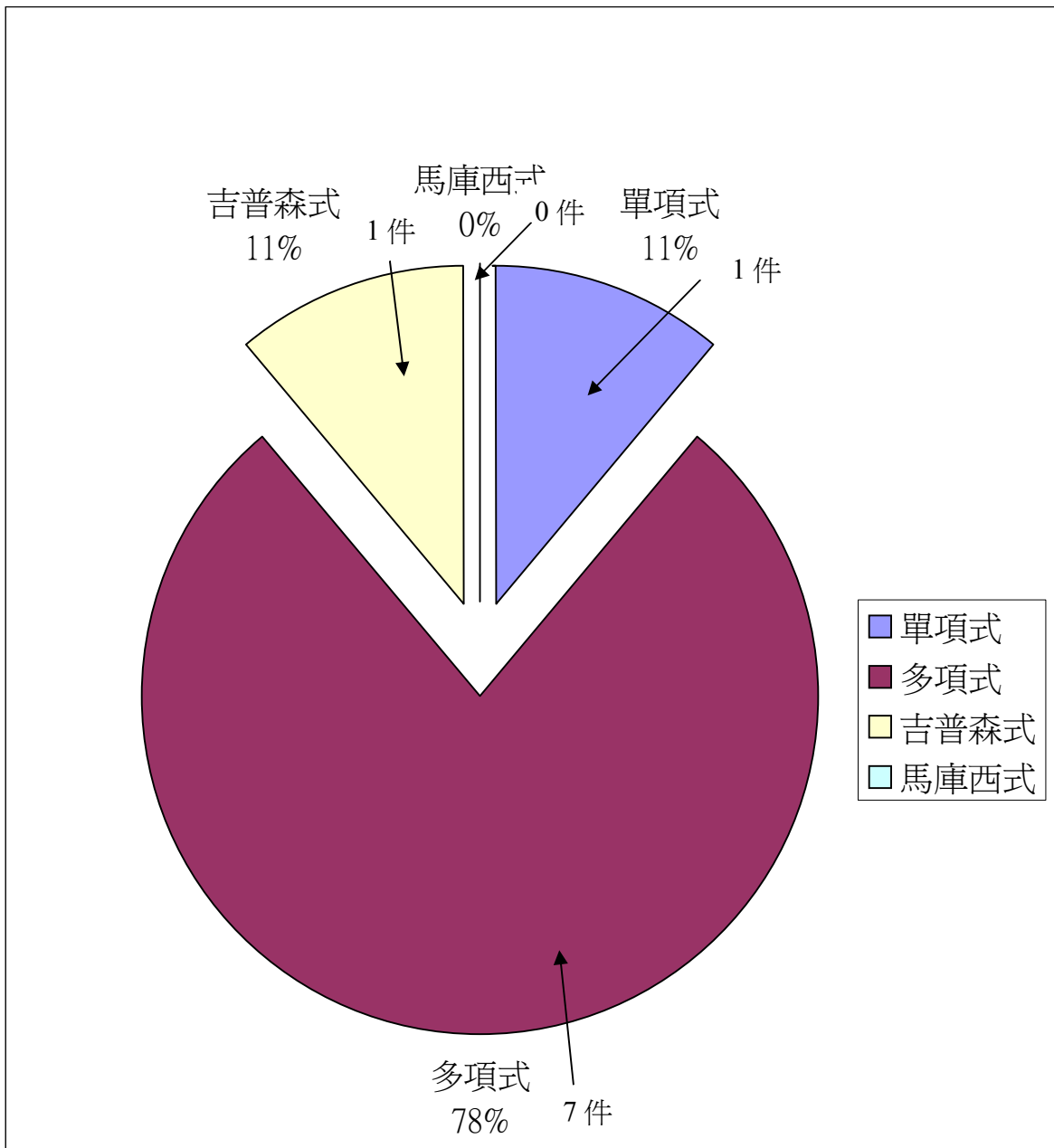
資料來源：本研究整理

表 5-2 專利事務所申請模式統計表

事務所	撰寫模式	件數	專利編號
聖島國際專利商標	單項式	1	B65D23/10
聯合事務所	多項式	2	H01R13/428 , H01R13/52
	吉普森式	0	
	馬庫西式	0	
理律法律事務所	單項式	0	
	多項式	3	H02G15/113 , H01H13/00 , B65D77/28
	吉普森式	0	
	馬庫西式	0	
台一國際商標事務所	單項式	0	
	多項式	2	B65G17/48 , H01L23/053
	吉普森式	1	B65D85/57
	馬庫西式	0	

資料來源:本研究整理

圖 5-1 撰寫模式所佔比例



資料來源:本研究整理

第六章 結論與建議

第一節 專利範圍侵權案例分析

為了更深入說明 claim 範圍的重要性，摘錄從 85 年 10 月智慧財產權管理寄刊第 11 期第 34 頁「陶瓷專利案例」為例加以說明，作者柳偉煌先生。抄錄該陶瓷專利範圍如下：

一種陶瓷器浮彩製法追加，係將顆粒大小介於 20 至 120 目濾網間所濾得之玻璃砂使其與錫日粉及水，以玻璃砂 30-60%：錫白細粉 25-55%：水 5%-30% 之比例均勻調和成黏著體，其特徵在於：

將黏著體塗繪於陶瓷器上預先畫好之圖紋輪廓內，待黏著體達不流動狀態形成浮釉後，入窯施以約略攝氏 600-1150 度之溫度燒烤約一至十二小時，使其浮釉固定於陶瓷器表面，出窯後再將浮釉圖案加以細部線條之修飾，以及著以粉彩，嗣而再送入窯中，以約莫攝氏 600-980 度之溫度窯燒概約一至十小時，使粉彩定色於陶瓷表面，形成色澤更臻鮮美亮麗、質感更加細緻完美之陶器浮彩者。

就作者柳偉煌先生的個人見解，這篇的專利範圍已隱藏著下列問題：

1. 如果有人仿造上述方法，而故意將燒烤時間延長為 13 小時以上，則不論依據侵權鑑定的「全要件原則」(All Elements Rule)，或先以「均等論」(Doctrine of Equivalents)解讀後再以「禁止反言」(File Wrapper Estoppel 或 Prosecution History Estoppel)來回頭限制均等論的適用範圍，其鑑定結果都會認為不構成侵權。這個不利的結果應是當初專利範圍的考慮失當所造成的，而無關乎是否有「包庇非法、殘害發明人」或涉及「行政暴力集團」的白色陰影。專利發明人此時不可不知。
2. 如果有人能不事先在陶瓷器上繪好圖案花紋(打底)，而直接以即興揮毫的方式將黏著體塗繪於陶瓷器表面，此種行為是否步及侵權仍不無爭辯餘地。因為從全要

件原則(All elements Rule)的鑑定角度來看，這種仿製行為至少已欠缺一個專利要件(element)，而必須利用均等論來解釋本案的專利範圍。與其到時爭訟雙方你來我往傷神地爭辯曲直，何不早於申請之時便設法釐清？

3. 如果方法中的黏著體成份還有其他的構成可能，那麼依照專利方法所揭露的步驟，發明人是否能同意第三人從事下列行為：例如，以不同的黏著體成份比例，依照本方法各步驟去生產浮彩陶瓷？又例如有人添加第三種材料粉末使燒製後的表面紋路、顏色呈現以發明當時的技術水準無法預測的瓷彩紋路效果時，一場商業利益衝突與侵權糾紛勢將難以避免。

作者柳偉煌先生解釋「何謂專利權項的多餘限制？」如何在眾多實施條件中適當取捨，首要考慮的是：本專利的基本目的是什麼？以本案為例，其基本目的是提供一種方法使粉彩定色於陶瓷器(浮釉層)表面，讓光線折射於釉層之中而使著上的粉彩色澤顯得格外鮮亮。接著考慮的是：什麼技術手段為要達成此一目的的基本要件？以本案為例，本案不可或缺的要件是利用黏著體塗繪—加熱—著彩—及二次加熱等步驟。任何適當成分的黏著體，都可能藉由上述步驟達成同於發明目的的效果；任何適當的烘烤，只要能使浮釉固定和粉彩定色於陶瓷器表面，都不會妨礙發明目的的達成，因此烘烤的條條在此不適合擺在獨立項裏。

為進一步說明以印證上述看法，作者柳偉煌先生試著將原來的專利範圍改寫如下：

(共七項)

(一) 一種陶瓷器浮彩製法，係採用一種能塗繪在陶瓷器表面而於加熱後變成固態釉層的黏著體，依如下步驟對陶瓷器進行加工：

1. 塗繪：將上述黏著體塗繪於陶瓷器上；
2. 加熱：等畫在陶瓷器上的黏著體乾固為浮釉後，對陶瓷器加熱至表面浮釉

完全固定為止；

3. 著彩：修飾陶瓷器表面浮釉圖案，並著以粉彩；及

4. 二次加熱：對陶瓷器再次加熱至使粉彩定色於陶瓷器表面為止。

(二) 如申請專利範圍第一項所述之陶瓷器彩製法，其中構成黏著體的主要成份為玻璃碎砂、錫細白粉及水等物質，經調和而成為黏著體。

(三) 如申請專利範圍第二項所述之陶瓷器彩製法，其中玻璃碎砂的粒徑大小以通過 20 至 120 目濾網所得者為宜。

(四) 如申請專利範圍第二項所述之陶瓷浮彩製法，其中黏著體的成份比例為：玻璃碎砂 30-60%，錫白細粉 25-55%，水 5-30% 所調製而成。

(五) 如申請專利範圍第一項所述之陶瓷器彩製法，其中步驟 a 之塗著步驟係將黏著體塗著於陶瓷器上預先畫好的圖紋輪廓內。

(六) 如申請專利範圍第一項所述之陶瓷器浮彩製法，其中步驟 b 之加熱步驟所用的加熱溫度介於攝氏 600-1150 度之間。

(七) 如申請專利範圍第一項所述之陶瓷器浮彩製法，其中步驟 d 之二次加熱步驟所用的加熱溫度介於攝氏 600-980 度之間。修改後的專利範圍，雖然技術內容大體上不變，但因權利範圍的結構差異而有不同的權利解釋。例如：第一項權利範圍，是以「加熱」一詞替代「窯燒」，將可禁止他人利用紅外線加熱裝置或以氫氧吹管等局部加熱設備取代窯燒。依照改寫後的專利範圍，倘若有人利用其他加熱設備於本方法製造平面瓷磚或瓷盤的浮彩效果(參考圖一)亦將構成侵害行為。

在改寫的第一項專利範圍中，作者柳偉煌先生把加熱溫度範圍移至附屬項，是因為各步驟的完成狀態與原定的溫度範圍及時間未必會有絕對相關，而卻絕對會與浮釉的固著及浮彩的定色與否有關。又鑑於熟悉該業的技術人士自應可依照自己的經驗掌握火候來完成各步驟，因此將溫度與時間範圍限制可以自獨立項移出。萬一將來有人以吾人意想不

到的溫度加熱，而能使浮釉固著及浮彩定色於瓷器浮釉表面，將因其所用的方法仍具備了該獨立項各個要件而構成侵權行為。

第二節 專利與申請的關係

企業為求在科技快速變遷的年代掌握商機、增強競爭能力，莫不投入大量資源於研究開發新產品或新技術，在當研發一有成果時應盡速申請專利來加以保護本身的智慧財產權，同時也可造成其他同業的進入市場的障礙以確保公司的利益。所以在專利申請時如何將所要保護的專利要項擴大其範圍便成為一門相當重要的學問。但在「請求專利記載」時應先妥善思考要採用何種模式來加以撰寫申請，才能夠獲得最大專利保護範圍。

一般人常認為自己的創作發明已申請專利便受到政府法律保護，殊不知其因所撰寫模式不同對於所能保護範圍便有所差異，發生侵權事項時又不能對侵權人提出法律行動，才在後悔當初怎麼會沒有申請保護到。所以在申請前妥善思考要採用何種模式來加以撰寫申請，才能確保自身權益。而專利申請事務所也應站在以客戶為導向來替客戶撰寫專利申請書，不能因自身撰寫申請方便，便將顧客權益來加以犧牲。其相關注意事項歸納如表6-1所示。

表6-1 撰寫模式特性

項次	撰寫模式	申請範圍	特性
1	單項式	各種事務專利申請範圍均適用	可含蓋專利保護範圍較大
2	多項式	各範事務專利申請範圍均適用	附屬項次越多則專利保護範圍更小
3	吉普森式	各事務專利申請範圍均適用	將所要申請專利要項明確表示
4	馬庫西式	化學類	附屬項次越多則專利保護範圍更大

資料來源:本研究整理

第三節 結論

專利範圍的推敲，必須從專利侵害的角度出發，並根據發明的基本目的來決定其基本要件。基本要件決定後，再根據各要件存在的基本目的決定其上位概念。能如此分析，相信已距離合適的專利範圍不遠。

一般人往往忽略專利範圍的重要性，而只注意詳細說明及圖式而已。要保護好你的發明成果，最好在完成專利說明書後申請之前，先請教專家並和他討論你的專利範圍是否已考慮周詳，以免將來空有專利證書而無實際權利令你後悔莫及。

第四節 建議

最後對於後續研究專利說明書之撰寫模式分析之研究者提出一些建議，希望他們能注意以下的議題，俾使相關之論文更趨完整。

1. 搜尋專利說明書的範圍應更擴大至其他的種類，如化學類在本次所搜尋的範圍並未含蓋到，同時也應多增加專利說明書的樣本數。
2. 本研究只針對國內前三大專利事務所來加以探討所能代表的範圍較小，後續研究者應可擴大其專利事務所間數來使本研究更加完善。
3. 本研究對於專利事務所選擇用何種撰寫模式的動機並未深入探討，後續研究者應可針對此一方向來使本研究更加完善。

參考文獻

註解部分

- 【1】經濟部，智財權教戰手冊，財團法人資訊工業策進會科技法律中心，2000.8。
- 【2】章忠信，智慧財產權基本概念，作者自印，2001.9。
- 【3】三〇一條款指的是美國國會在一九七四年所制定的貿易法（Trade Act of 1974）第三篇第一章第三〇一條。根據該條款，假使外國政府採取不正當（unjustifiable）、不合理（unreasonable）、歧視性（discriminatory）之貿易政策、法律、措施，導致美國商業受到限制，此時美國總統有權採取適當的反應措施。而特別三〇一條款（special 301）乃是一九八八年綜合貿易及競爭力法對三〇一條款加以修正擴充，明文規定 USTR 對於智慧財產權保護不週的外國貿易伙伴，必須於六個月內以諮商的方式來解決，否則 USTR 必須依三〇一條款予以報復。其與三〇一條款之主要差別在於三〇一條款主要目的為促進自由貿易，而特別三〇一條款乃在於限制外國對美國智慧財產權自由使用。並將下列二種國家名單置於其對國會的年度報告（「國家貿易評估」（National Trade Estimate, NTE））：1. 拒絕對智慧財產權提供適當及有效保護（adequate and effective protection）的國家。2. 拒絕讓依賴智慧財產權之美國人公平進入其市場的國家。另外，所謂的超級三〇一程序乃是美國國會於一九九八年通過的綜合貿易及競爭力法，並賦予 USTR 新的任務，即「優先國家」（Priority foreign countries）的認定。USTR 向國會提出的 NTE 的報告中，將指出優先國家。並於提出後二十一日內展開調查，與之談判，目標在於三年內促使其消除不公平貿易之措施，否則將採報復措施。
- 【4】1993 年第八次烏拉圭回合會談，使關貿總協（GATT）由原先單純的國際經貿協定，轉化成為實質的世界貿易組織（World Trade Organization；WTO），其成立於 1995 年 1 月 1 日。WTO 及其協定以涵蓋服務業及發明、創造及設計（智慧財產權）所產生的科技其目的在強化世界經濟主體間的平等貿易及互惠，使各個經濟主體兼有

更多的商業交易、投資機會、工作及收入均有成長。

- 【5】二次世界大戰結束後，美國與一些國家成立一個國際貿易組織（International Trade Organization；ITO），其目的為解除 1930 年代以來各國的貿易堡壘。然 ITO 未被美國國會所接受，因此各國在 1948 年又協商成立關稅暨貿易總協定（General Agreements on Tariffs and Trade；GATT）（簡稱「關貿總協」）。
- 【6】烏拉圭回合協定法案（URAA）係美國為符合 WTO 協定所制定的綜合立法，於一九八六年開始，於一九九三年十二月十五日達成最終協議，並於一九九四年四月於摩洛哥簽署最終協議文件，內容涵蓋各種與 WTO 協定所規範的多邊與複邊協定的相關法律。
- 【7】TRIPS 協定第一篇第一條第二項規定：「本協定所稱智慧財產係指第二篇第一節至第七節所保護之各類智慧財產」。
- 【8】TRIPS 協定第三十九條第二項對「未公開資訊」定義為：「a. 具有秘密性質，其形態及成分之組合，並非一般處理同類資料之業者所知悉或易於取得者。b. 因其秘密性而具有商業價值。c. 經資料合法持有人以合理步驟保持其秘密性。」。
- 【9】陳長文(1995)認為智慧財產權之保護對工商社會之正面意義：1. 鼓勵研究發展及創作。2. 加強投資人對新產品投資之興趣。3. 增進工商業技術水準以達到工商業發展之目的。4. 使智慧財產權成為貿易標的物。5. 防止不公平競爭。詳參見 <http://www.apipa.org.tw/apipa/b5/papers/ip/sandy7.htm>
- 【10】Brooking 認為智慧資產（Intellectual capital）可以分成四個部分：1. 行銷（Market assets）。2. 智慧財產（Intellectual property assets）。3. 人力（Human-centred assets）。4. 公共建設（Infrastructure assets）。（詳參見 Brooking（1996），Intellectual Capital, International Thomson Business Press.）
- 【11】徐小波，「科技智慧財產權之保護、管理與運用」，產業科技研究發展管理論文

集，經濟部科技顧問室，1990。

- 【12】 馮震宇，「了解智慧財產權」，永然文化出版，頁 17，1998。
- 【13】 謝銘洋，「智慧財產權之基礎理論」，翰蘆圖書，頁 32，1997。
- 【14】 賴源河，「貿易保護下之智慧財產權」，黎明文化，頁 11，1991。
- 【15】 陳偉潔，「與中華民國半導體產業教父談智慧財產權-張忠謀博士專訪」，智慧財產權管理季刊，第四期，頁 25，1995。
- 【16】 Timo R. Nyberg and Sami Saru (1999)，”Aspects on high technology transfer”，Technology management，18(5)，p605。
- 【17】 李茂堂，「智慧財產權實務」，健行文化出版，頁 13-16，1997。
- 【18】 鄭成思，「智慧財產權法」，水牛，頁 3-5，1991。
- 【19】 孫祥禮，「專利跨步走」，智慧財產權管理季刊，第二十一期，頁 5，1999。
- 【20】 李復甸及鄭中人，「智慧財產權導論」，五南，頁 6-9，1999。
- 【21】 陳歆，「談專利的攻防策略」，智慧財產權管理季刊，第九期，頁 20-21，1996。
- 【22】 陳哲宏等著，「專利法解讀」，月旦出版，頁 14，1994。
- 【23】 張禹治譯，「專利奇兵：智慧有價時代的另類無限商機」，時報文化，頁 17-18，1997。
- 【24】 專利法第一條。
- 【25】 專利法第二條。
- 【26】 李茂堂，「專利法實務」，健行文化出版，頁 38-44，1997。
- 【27】 專利法第五十條、第一百條、第一百零九條。
- 【28】 專利法第七條。
- 【29】 專利法第八條。
- 【30】 法務部，法務智權園地，作者自印，1997.2。
- 【31】 陳家駿等著，專利管理高手，財團法人資訊工業策進會科技法律中心，2000.8。

- 【32】 陳哲宏等著，「專利法解讀」，月旦，頁 14-15，1994。
- 【33】 謝銘洋，「智慧財產權之基礎理論」，謝銘洋發行，翰蘆圖書總經銷，頁 32，1997。
- 【34】 夏文龍，「專利對產業界的價值」，智慧財產權管理季刊，第十六期，頁 20-21，1998。
- 【35】 祈明輝，「專利於產品研發所扮演之角色」，智慧財產權，頁 41-43，1999。
- 【36】 專利法第 56 條：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖示。」
- 【37】 劉尚志等，產業競爭與專利策略，科技發展政策報導，2000.8
- 【38】 林大器口述、張聖怡整理，「建立更有效的專利管理制度」，智慧財產權管理季刊，第十九期，頁 6-7，1998。
- 【39】 林宏六、蒲莉平，「世界貿易組織（WTO）對技術貿易與專利保護的重視-就貿易侵權的行為分析」，智慧財產權，頁 52，1999。
- 【40】 劉尚志等，專利分析與科技競爭，保護智慧財產權系列講習會，國科會，1993.9。
- 【41】 智慧財產權實用六法，財團法人資訊工業策進會科技法律中心，2000.11。
- 【42】 林宏六、蒲莉平，「世界貿易組織（WTO）對技術貿易與專利保護的重視-就貿易侵權的行為分析」，智慧財產權，頁 52，1999。
- 【43】 積體電路布局保護法第一條。
- 【44】 積體電路布局保護法第 7 條。
- 【45】 陳美如，「科學園區高科技公司管理之優勢原則」，國立交通大學管理科學研究所碩士論文，1991。
- 【46】 Boretzky, The Threat to U.S. High Technology Industries: Economic and

National Security Implications Draft , International Administration , U.S. Department of Commerce , 1982 。

- 【47】 Maidique&Hayes, ” The Art of High-Technology Management, ” Sloan Management Review , Winter , p17-31 , 1984 。
- 【48】 Bleicher&Paul, ” Management Framework for Innovative Responses in High-Tech Organization, ” , Business Horizons , November-December , p69-78 , 1983 。
- 【49】 Kelly, The Impact of Technological Innovation on International Trade Patterns. Patterns. office of International Economic Research, U. S. Departement of Commerce , 1977 。
- 【50】 Davis, Technology Intensity of U. S. Output and Trade. Office of Trade and Investment , Analysis U. S. Department , 1982 。
- 【51】 Riggs, Managing High-Technology Companies. Lifetime Learning Publications , 1983 。
- 【52】 Bleicher, ” Managerial Framework for Innovation Responses in High-Tech Organization ” Business Horizons, November-December, pp69-78 , 1983 。
- 【53】 Roger & Larsen , Silicon Vally Fever. Commonwealth Publishing Co. , 1984 。
- 【54】 Riggs, Managing High-Tech Companies. Van Nostrano Reinhold, N. Y. , 1985 。
- 【55】 嚴永晃, 「我國高科技產業結構之初步分析」, 作者出版, 頁 10-14 。1984 。
- 【56】 江炯聰, 「高度技術產業之經營管理發展策略」, 台灣經濟研究月刊, 第七卷第一期, 頁 63-72 , 1984 。
- 【57】 陳以玲, 「往高科技工業之路-新竹科學園區的現在與未來」, 資訊與電腦, 第五十七期, 頁 32-36 , 1985 。
- 【58】 毛治國, 「高科技企業及其戰略面與管理面之特性」, 現代管理月刊, 頁 64-66 ,

1985。

- 【59】 曾銘深，「我國高科技工業之發展政策」，台灣經濟研究月刊，第二十一期，頁63-72，1986。
- 【60】 劉瑞圖，「發展高科技產業之途徑」，工業簡訊，第十八卷第二期，頁14-27，1988。
- 【61】 鄧朝貴，「提升高科技生產力之研究」，國立交通大學管理科學研究所碩士論文，1984。
- 【62】 Bollinger, Lynn&Katherine, A Review of Literature and Hypothesis on New Technology-Base Firms, Research Policy 1983.
- 【63】 Shanklin&Ryan, "Organizing for High-Tech Marketing", Harvard Business Review p164-171, 1984。
- 【64】 Mar, Newell&Saxberg, Managing High Technology:An Interdisciplinary Perspect, Elsevier Science Publishing 1985。
- 【65】 蔡明誠，發明專利法研究，著者發行，國立臺灣大學法學院圖書部經銷，頁一七五，民87。
- 【66】 鄭中人，論專利權之性質（上）（下），司法週刊第八八七、第八八八期
- 【67】 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，著者發行，三民總經銷，頁十二，民83。
- 【68】 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，著者發行，三民總經銷，頁十二至二十，民83。
- 【69】 歐洲專利公約第八十四條：「申請專利範圍應對所要保護之對象加以定義。申請專利範圍應清楚與明確且為發明說明所支持。」；美國專利法第一一二條「說明書應包括發明之文字敘述及其製造、使用方法和程序之敘述，使任何熟悉該行業有關人士或最具關聯人員，均得以該完整、清晰及精簡、正確之文詞即可製造並且使用

其相同產品，且說明書應記載發明人實施其發明所可設想之最佳方式。」

- 【70】 歐洲專利公約第七十八條、第一二三條；歐洲專利公約規則第二十九條、第三十條及第八十六條。
- 【71】 邱素真，影響發明或新型專利之可專利範圍之因素及問題點，智慧財產權第二十一期，頁 58 至 64，民 89/9 月。
- 【72】 邵宇奇，以多觀點構思結構化之權利請求項，工業財產與標準，第五十六期，頁 68 至 73，民 86/11 月。
- 【73】 特定技術領域之審查基準－電腦軟體相關之發明，
http://www.tien-liipr.com.tw/sele_wtt/LAW/PAT02R.HTM
- 【74】 馮震宇，實用科技智財法全書，作者自印，頁 116 至 120，1999 年 12 月。
- 【75】 洪瑞章，功能手段語言申請專利範圍之解釋，智慧財產季刊，第三十三期，頁 74 至 78，2000 年 4 月，。
- 【76】 李文賢，專利法刑罰規定之研究，東吳大學法研所碩士論文，謝銘洋指導，頁 85，民 88/6 月。
- 【77】 黃文儀，專利法逐條解說，三民總經銷，頁 86 至 87，民 88。
- 【78】 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，三民總經銷，頁 511，民 83。

中文部份

中華民國專利法。

中華民國積體電路布局保護法。

毛治國，「高科技企業及其戰略面與管理面之特性」，現代管理月刊，頁 64-66，1985。

江炯聰，「高度技術產業之經營管理發展策略」，台灣經濟研究月刊，第七卷第一期，頁 63-72，1984。

李文賢，專利法刑罰規定之研究，東吳大學法研所碩士論文，謝銘洋指導，頁 85，民 88/6 月。

李茂堂，「專利法實務」，健行文化出版，頁 38-44，1997。

李茂堂，「智慧財產權實務」，健行文化出版，頁 13-16，1997。

李復甸及鄭中人，「智慧財產權導論」，五南，頁 6-9，1999。

林大器口述、張聖怡整理，「建立更有效的專利管理制度」，智慧財產權管理季刊，第十九期，頁 6-7，1998。

林宏六、蒲莉平，「世界貿易組織（WTO）對技術貿易與專利保護的重視-就貿易侵權的行為分析」，智慧財產權，頁 52，1999。

法務部，法務智權園地，作者自印，1997.2。

邵宇奇，以多觀點構思結構化之權利請求項，工業財產與標準，第五十六期，頁 68 至 73，民 86/11 月。

邱素真，影響發明或新型專利之可專利範圍之因素及問題點，智慧財產權第二十一期，頁 58 至 64，民 89/9 月。

洪瑞章，功能手段語言申請專利範圍之解釋，智慧財產季刊，第三十三期，頁 74 至 78，2000 年 4 月。

祈明輝，「專利於產品研發所扮演之角色」，智慧財產權，頁 41-43，1999。

夏文龍，「專利對產業界的價值」，智慧財產權管理季刊，第十六期，頁 20-21，1998。

孫祥禮，「專利跨步走」，智慧財產權管理季刊，第二十一期，頁 5，1999。

徐小波，「科技智慧財產權之保護、管理與運用」，產業科技研究發展管理論文集，經濟部科技顧問室，1990。

特定技術領域之審查基準－電腦軟體相關之發明，

http://www.tien-liipr.com.tw/sele_wtt/LAW/PAT02R.HTM

張禹治譯，「專利奇兵：智慧有價時代的另類無限商機」，時報文化，頁 17-18，1997。

陳以玲，「往高科技工業之路-新竹科學園區的現在與未來」，資訊與電腦，第五十七期，頁 32-36，1985。

陳美如，「科學園區高科技公司管理之優勢原則」，國立交通大學管理科學研究所碩士論文，1991。

陳哲宏等著，「專利法解讀」，月旦，頁 14-15，1994。

陳哲宏等著，「專利法解讀」，月旦出版，頁 14，1994。

陳家駿等著，專利管理高手，財團法人資訊工業策進會科技法律中心，2000.8。

陳偉潔，「與中華民國半導體產業教父談智慧財產權-張忠謀博士專訪」，智慧財產權管理季刊，第四期，頁 25，1995。

陳歆，「談專利的攻防策略」，智慧財產權管理季刊，第九期，頁 20-21，1996。

章忠信，智慧財產權基本概念，作者自印，2001.9。

智慧財產權實用六法，財團法人資訊工業策進會科技法律中心，2000.11。

曾銘深，「我國高科技工業之發展政策」，台灣經濟研究月刊，第二十一期，頁 63-72，1986。

馮震宇，「了解智慧財產權」，永然文化出版，頁 17，1998。

馮震宇，實用科技智財法全書，作者自印，頁 116 至 120，1999 年 12 月。

黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，三民總經銷，頁 511，民 83。

黃文儀，專利法逐條解說，三民總經銷，頁 86 至 87，民 88。

經濟部，智財權教戰手冊，財團法人資訊工業策進會科技法律中心，2000.8。

劉尚志等，專利分析與科技競爭，保護智慧財產權系列講習會，國科會，1993.9。

劉尚志等，產業競爭與專利策略，科技發展政策報導，2000.8。

劉瑞圖，「發展高科技產業之途徑」，工業簡訊，第十八卷第二期，頁 14-27，1988。

蔡明誠，發明專利法研究，著者發行，國立臺灣大學法學院圖書部經銷，頁一七五，民 87。

鄭中人，論專利權之性質（上）（下），司法週刊第八八七、第八八八期。

鄭成思，「智慧財產權法」，水牛，頁 3-5，1991。

鄧朝貴，「提升高科技生產力之研究」，國立交通大學管理科學研究所碩士論文，1984。

賴源河，「貿易保護下之智慧財產權」，黎明文化，頁 11，1991。

謝銘洋，「智慧財產權之基礎理論」，翰蘆圖書，頁 32，1997。

嚴永晃，「我國高科技產業結構之初步分析」，作者出版，頁 10-14。1984。

英文部份

Bleicher&Paul, " Management Framework for Innovative Responses in High-Tech Organization," , Business Horizons , November-December , p69-78 , 1983 .

Bleicher, " Managerial Framework for Innovation Responses in High-Tech Organization" Business Horizons, November-December, pp69-78 , 1983 .

Bollinger, Lynn&Katherine, A Review of Literature and Hypothesis on New Technology-Base Firms , 1983 .

Boretsky, The Threat to U.S. High Technology Industries:Economic and National Security Implications Draft , International Administration , U.S. Department of Commerce , 1982 .

Brooking, Intellectual Capital, International Thomson Business Press , 1996

Davis, Technology Intensity of U.S. Output and Trade. Office of Trade and Investment , Analysis U.S. Department , 1982 .

Kelly, The Impact of Technological Innovation on International Trade Patterns. Patterns. office of International Economic Research, U.S. Department of Commerce , 1977 .

Maidique&Hayes, " The Art of High-Technology Management," Sloan Management Review , Winter , p17-31 , 1984 .

Mar, Newell&Saxberg, Managing High Technology:An Interdisciplinary Perspect , 1985 .

Riggs, Managing High-Tech Companies. Van Nostrano Reinhold, N. Y. , 1985 .

Riggs, Managing High-Technology Companies. Lifetime Learning Publications , 1983 .

Roger & Larsen ,Silicon Vally Fever.Commonwealth Publishing Co. , 1984 ◦

Shanklin&Ryan, ” Organizing for High-Tech Marketing” ,p164-171 , 1984 ◦

Timo R. Nyberg and Sami Saru , ”Aspects on high technology transfer” , Technology management , 18(5) , p605 , 1999 ◦

自 述

作者：黃國賢

籍貫：台灣省台南縣

生日：民國 61 年 6 月 5 日

學歷：民國 88 年 6 月私立南台科技大學電機工程學系畢業

民國 92 年 6 月國立成功大學工學院工程管理所畢業

經歷：民國 85 年 3 月~民國 88 年 5 月

堤維西交通工業股份有限公司生技工程師

民國 88 年 6 月~民國 88 年 10 月

堤勝工業股份有限公司生技課課長

民國 88 年 10 月~民國 91 年 4 月

堤勝工業股份有限公司生產部襄理

民國 91 年 4 月~民國 92 年 4 月

昱慶特殊印刷股份有限公司生產部經理

民國 92 年 5 月~迄今

華美電子股份有限公司台灣廠廠長